

# 2024年3月期 通期決算説明資料

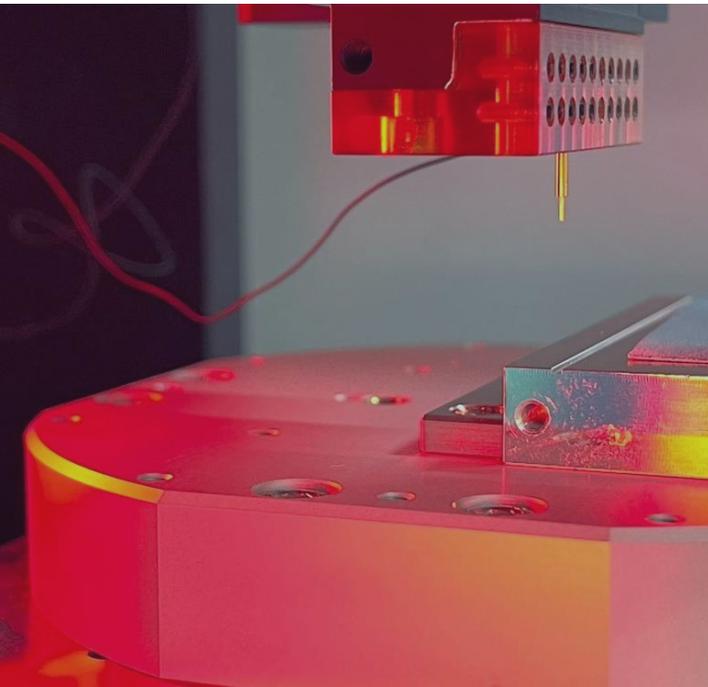
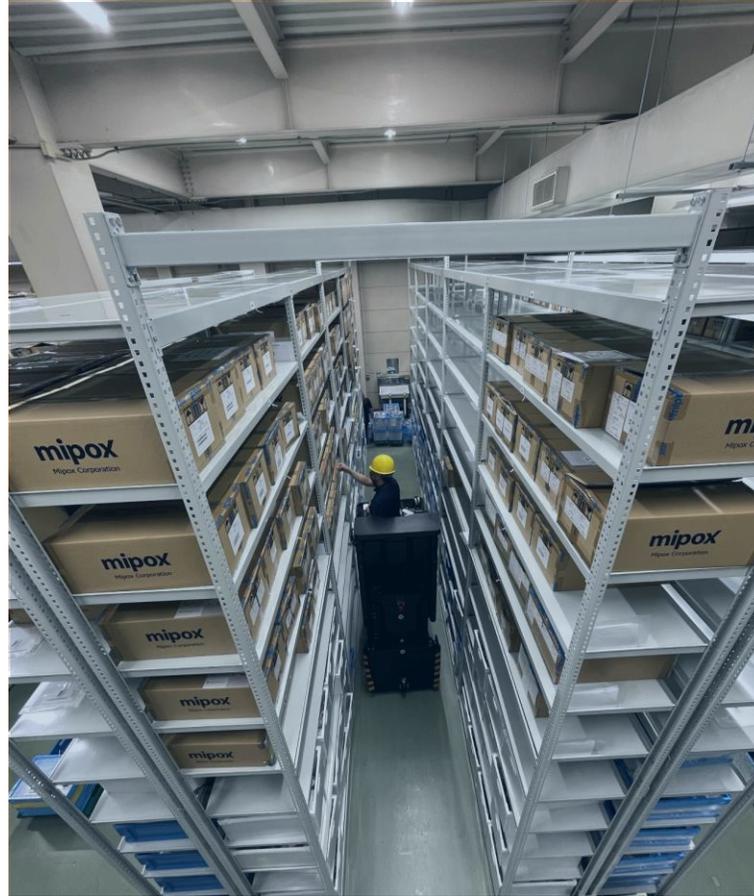
---

Mipox株式会社(マイボックス) 証券コード 5381

---

2024年5月15日

# Agenda



01 会社概要

02 2024年3月期 通期実績

03 通期業績見通し

04 事業内容

05 競争力の源泉

06 成長戦略

07 Appendix

会社名	Mipox (マイポックス) 株式会社
英文名	Mipox Corporation
創業	大正14年(1925)年11月21日
設立	昭和16年(1941)年12月12日
代表取締役社長	渡邊 淳 (Jun Watanabe)
本店・本社	〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18
株式市場名	東京証券取引所 スタンダード
証券コード	5381



## 経営方針

エンジニアリングアプローチによる製品事業の付加価値向上



受託事業から  
エンジニアリングサービス事業への転換

早い変化と多様性に対応できる  
経営基盤の整備

## 「塗る、切る、磨く」を極めた技術力

創業から続く箔の製造技術を応用することで「塗る」「切る」「磨く」技術をコアにした事業を展開した企業です。

コア技術を組み合わせ、お客様の成功のための付加価値を創造するための製品とサービスを提供します。

### 塗る Coating

PETフィルム、銅箔、織布、紙等の基材に、調合した樹脂等の塗料を均一に塗布。

自社製品である研磨材や反射材だけでなく、保有する複数の塗工機によってご要望に合わせた機能性フィルムの製造も実現。

### 切る Slitting

「塗る」ことで出来た製品を希望のサイズに裁断(スリット)。

高精度さが求められるハードディスク向け研磨フィルムの製造で培った技術によって、裁断が困難といわれている素材でも精度の高い切り口と巻き上げを実現し、高品質の製品を提供。

### 磨く Polishing

徹底的な顧客視点を持った製品開発のために自社の研磨材と独自の研磨装置で研磨プロセスの研究を積み重ねる。

ハイテク分野で培った高精度研磨加工技術で次世代半導体ウェーハの研磨にも挑戦し、研磨市場に於けるプロフェッショナルを目指します。

	拠点開設	事業領域	売上高(百万円)	トピックス	
1925	東京都京橋区にて設立	製品事業 受託事業		顔料と色箔の輸入業者としてドイツ資本により設立(独逸顔料合名会社)	
1981				日本マイクロコーティング㈱へ商号変更	
2001			6,858	JASDAQ店頭市場に上場	
2002			4,439		
2003			4,949		
2004			7,197		
2005			10,799		
2006			8,966		
2007			8,329		
2008			6,083		
2009			3,238		2009年3月期 渡邊淳が代表取締役社長に就任(現代表)
2010			3,013		受託事業強化
2011			3,157		
2012	インド、中国(上海)		3,045		
2013	フィリピン		2,815 594 3,409		Mipox㈱へ商号変更、本社を東京都立川市へ移転
2014	台湾		3,202 558 3,760		
2015	京都府京都市		3,606 379 3,985		日本レフライト工業㈱を子会社化、Mipox Kyoto㈱を設立
2016	ベトナム、広島県福山市		3,930 274 4,204		日本研紙㈱を子会社化
2017			6,219 190 6,410		Mipox Kyoto㈱を吸収合併
2018			7,009 816 7,826		
2019			7,083 474 7,558		日本研紙㈱の営業機能を統合
2020	中国(深セン)		6,832 506 7,338		Ref Liteのリブランド
2021	広島県呉市		6,416 944 7,361		本店を山梨県北杜市へ移転、日本研紙㈱を吸収合併、オムニ・カーボナイト事業を吸収分割
2022	栃木県鹿沼市	7,570 2,879 10,449		ミスミ化学㈱を子会社化、本社を東京都四谷に移転	
2023		7,948 2,080 10,029		本店本社を栃木県鹿沼市へ移転、㈱スガコーディングスの粉体塗装事業を譲受	
2024		7,618 1,735 9,354		鹿沼事業所集約により京都工場を閉鎖、(有)大久保鉄工所を子会社化、インド工場を移転	

製品事業

研磨材の製造・販売

売上高  
構成比 **81%**

■ **ハイテク関連製品 37%**

HDD関連、半導体、光ファイバー等で使用される  
研磨材の製造・販売

■ **一般研磨関連製品 44%**

自動車、鉄鋼関連等で使用される  
研磨材の製造・販売

受託事業

顧客から材料の支給を受け  
当社グループが保有する設備で受託加工

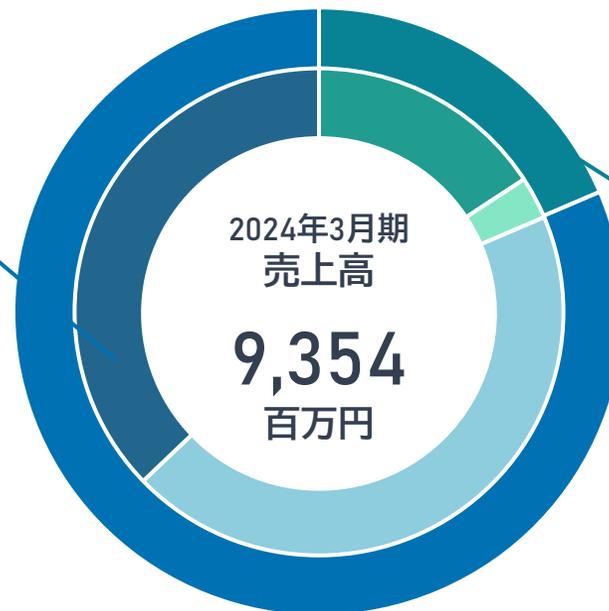
売上高  
構成比 **19%**

■ **受託塗布・スリット 16%**

顧客からフィルムや塗料材等を預かり、  
当社設備を使用して加工製造

■ **受託研磨加工 3%**

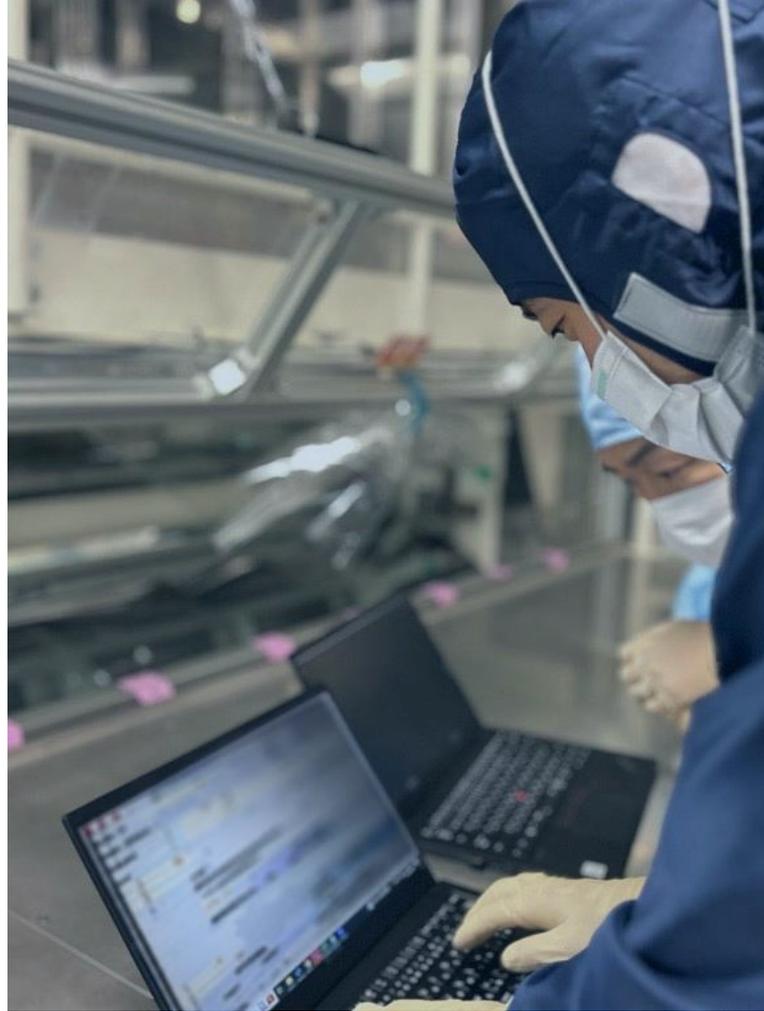
半導体用途を中心にウェーハ等の材料を預かり、  
当社の研磨材と設備を使用して研磨加工



国内外売上高比率(2024年3月期)



# Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期 通期実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

## 売上高

9,354百万円

前年同期比較

674百万円減少 (▲6.7%)

## 営業利益

▲442百万円

前年同期比較

655百万円減少 (-%)

## 経常利益

▲186百万円

前年同期比較

612百万円減少 (-%)

親会社株主に帰属する  
当期純利益

▲408百万円

前年同期比較

453百万円減少 (-%)

## 自己資本比率

46.8%

前年同期比較

2.6pt減少

## 業績概要

2024年3月期下半期から業績は回復傾向にありますが、上半期までの減収・減益を補えず、通期では左記の通り各段階利益で赤字となりました。

上半期まで主に当社の製品事業セグメントのハイテク関連製品の主要マーケット(半導体、ハードディスク、光ファイバー)の低迷がありました。

下半期からは、徐々にこれらマーケットは回復の兆しが見え始め、下半期では営業利益が黒字に転じました。製品事業の一般研磨関連製品は安定的な推移を継続しています。

2024年3月期は受託事業セグメントは減収しておりますが、新たに一般受託領域である有限会社大久保鉄工所の取得により、より安定的な業績基盤の構築を進めています。

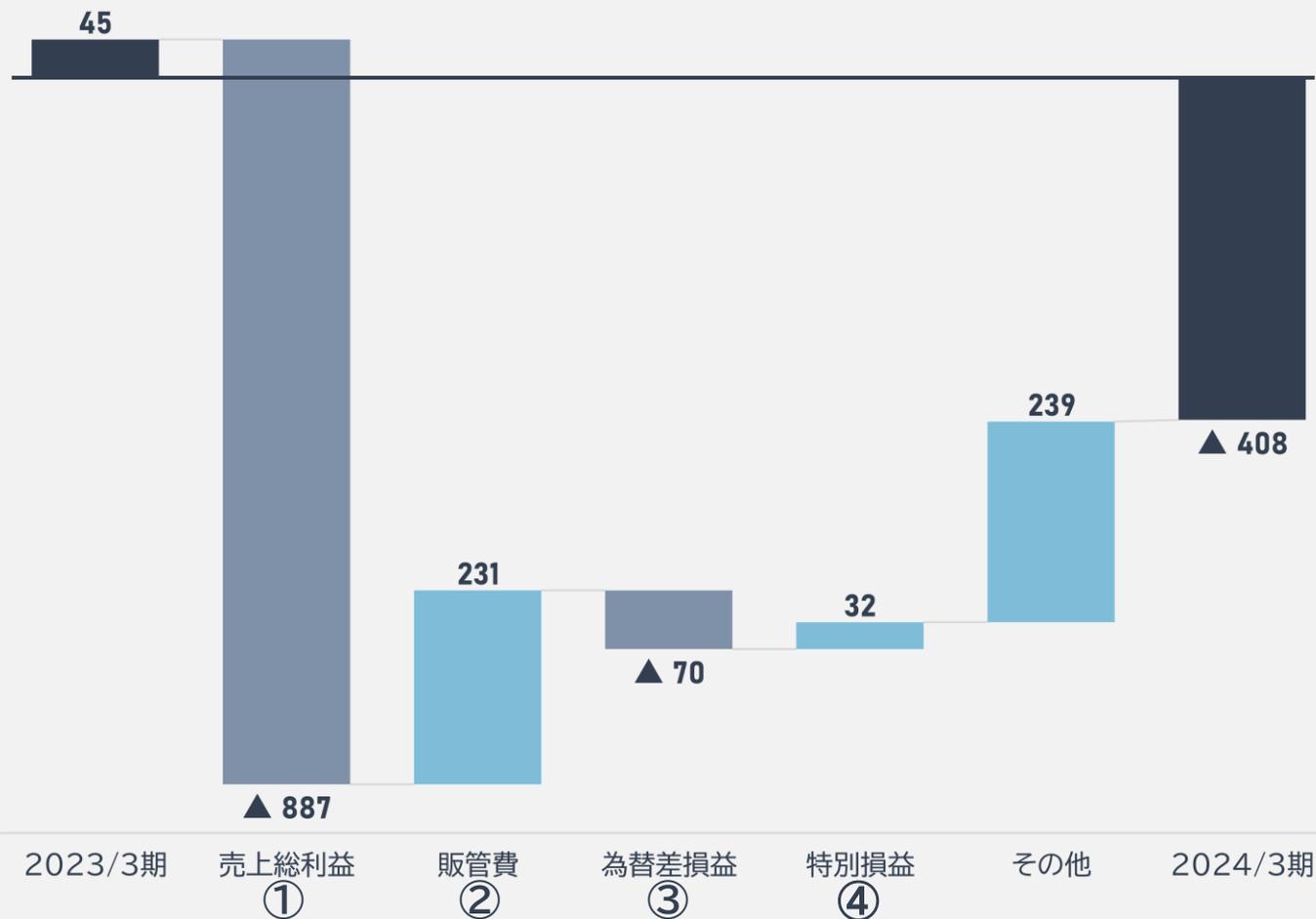
※増減算出後、百万未満切捨て

(単位:百万円)

	2023/3期	2024/3期	前年同期比
売上高	10,029	9,354	▲6.7%
売上総利益	3,464	2,577	▲25.6%
販売費及び一般管理費	3,251	3,019	▲7.1%
営業利益	212	▲442	-
為替差益	204	133	▲34.6%
経常利益	426	▲186	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	45	▲408	-

※百万円未満切り捨て、業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

(単位:百万円)



※増減算出後、百万未満切捨て

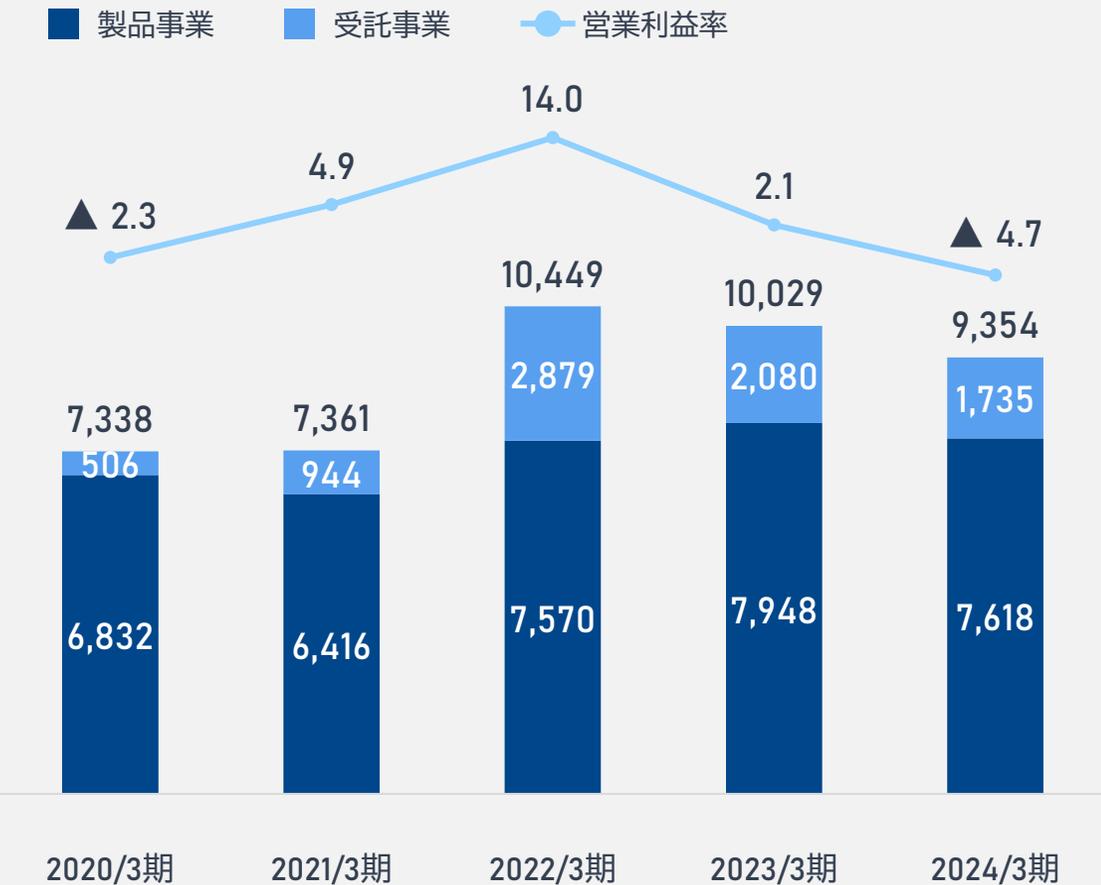
## 利益減少要因

- ① 上半期の売上高減少や棚卸資産の評価損等の影響により、固定費が先行し売上総利益が大きく減少いたしました。
- ② 変動費である物流費用を中心に販管費が減少いたしました。鹿沼事業所の物流機能を活用し、他拠点で契約している外部倉庫の解約を進める等によるコスト削減も進めております。
- ③ 円安傾向が継続しており、2024年3月期も為替差益のポジションにありますが、対前年同期比では減少いたしました。
- ④ 中国子会社の清算や京都工場の売却益が特別利益に計上されている一方、2021年に取得した広島県呉市の開発生産設備およびのれんの減損損失を計上いたしました。

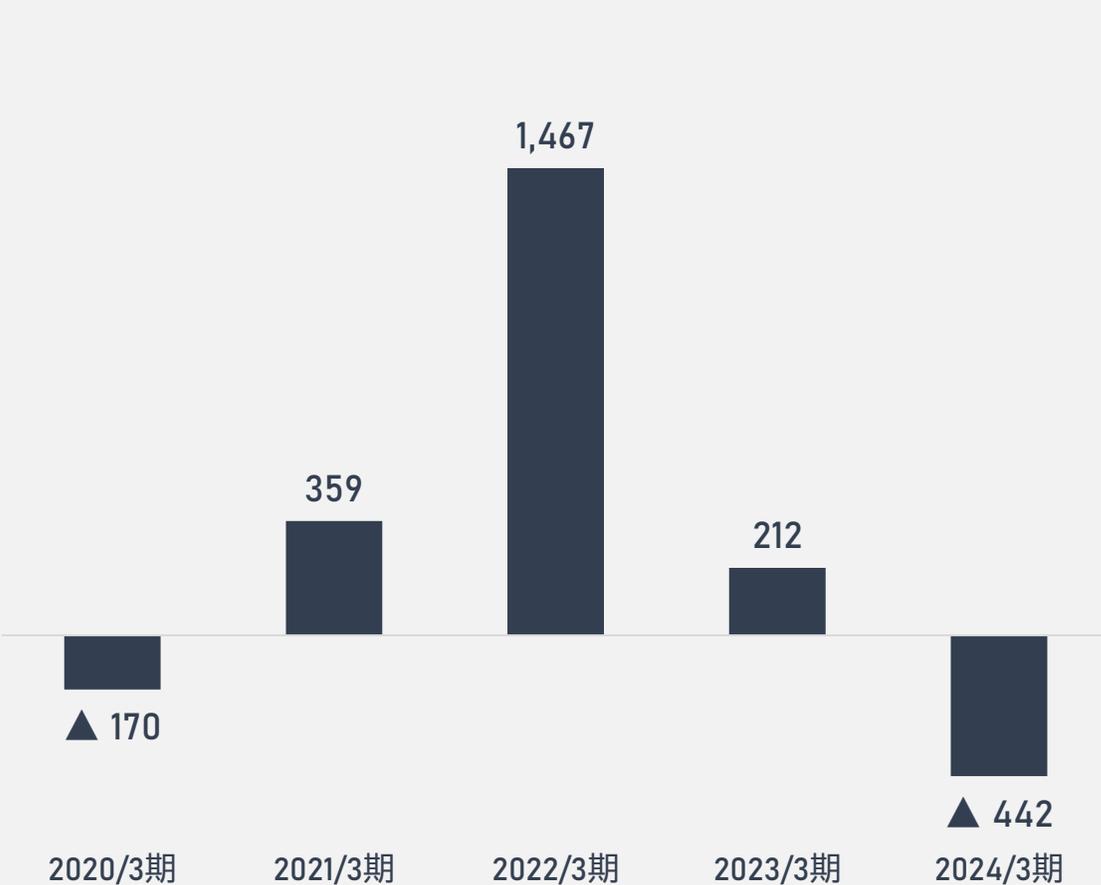
## 02 通期業績推移(連結)

- 2024年3月期は通期売上高が100億円を下回り、営業損失を計上いたしました。製品事業は主にハイテク関連製品、受託事業は主に受託研磨加工が減少いたしました。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)

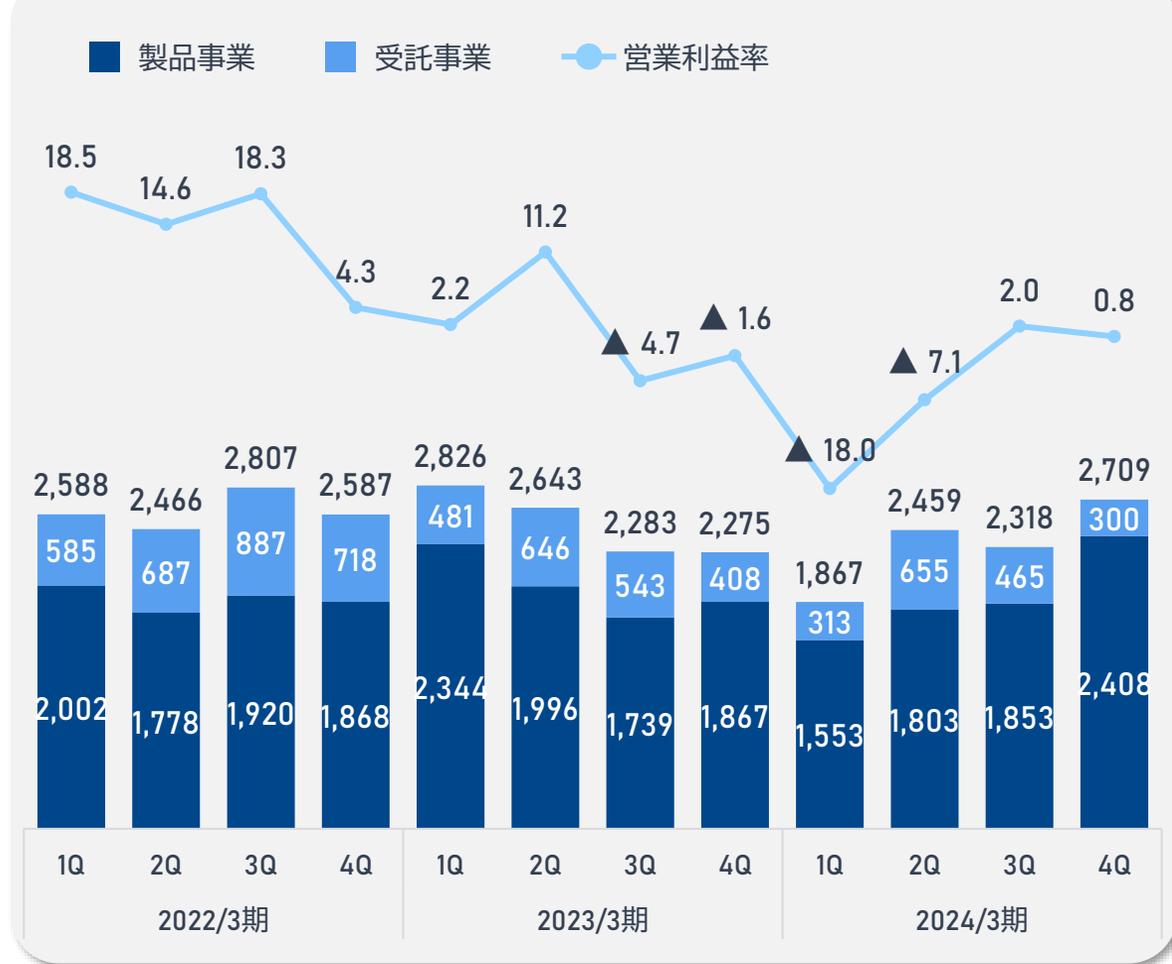


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

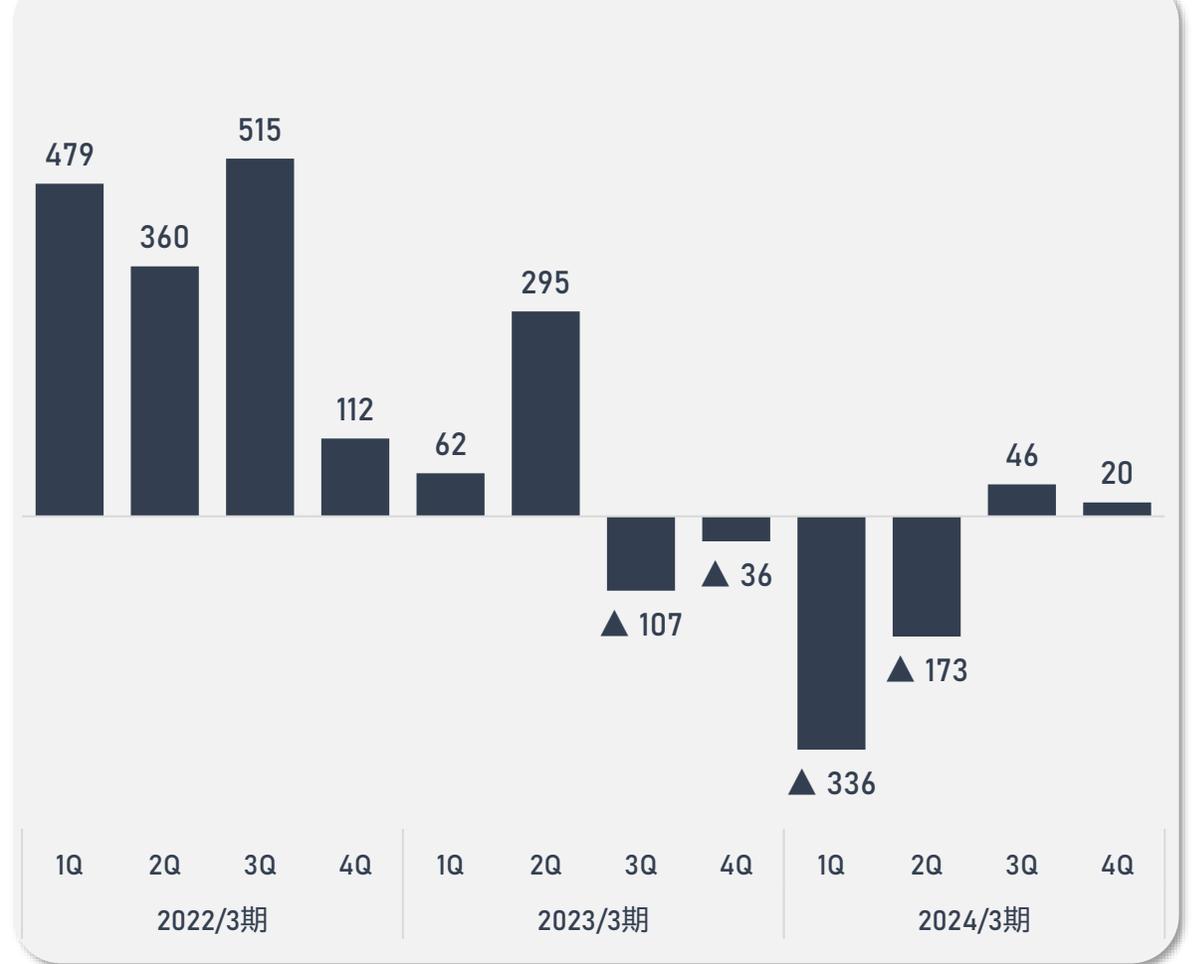
## 02 四半期業績推移(連結)

- 四半期推移では、2024年3月期第4四半期の製品事業は、過去3年で最大の売上高となりました。一方、受託事業は同第4四半期は最小の売上高でした。
- 第3四半期から製品事業が牽引し、営業利益を計上しています。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)

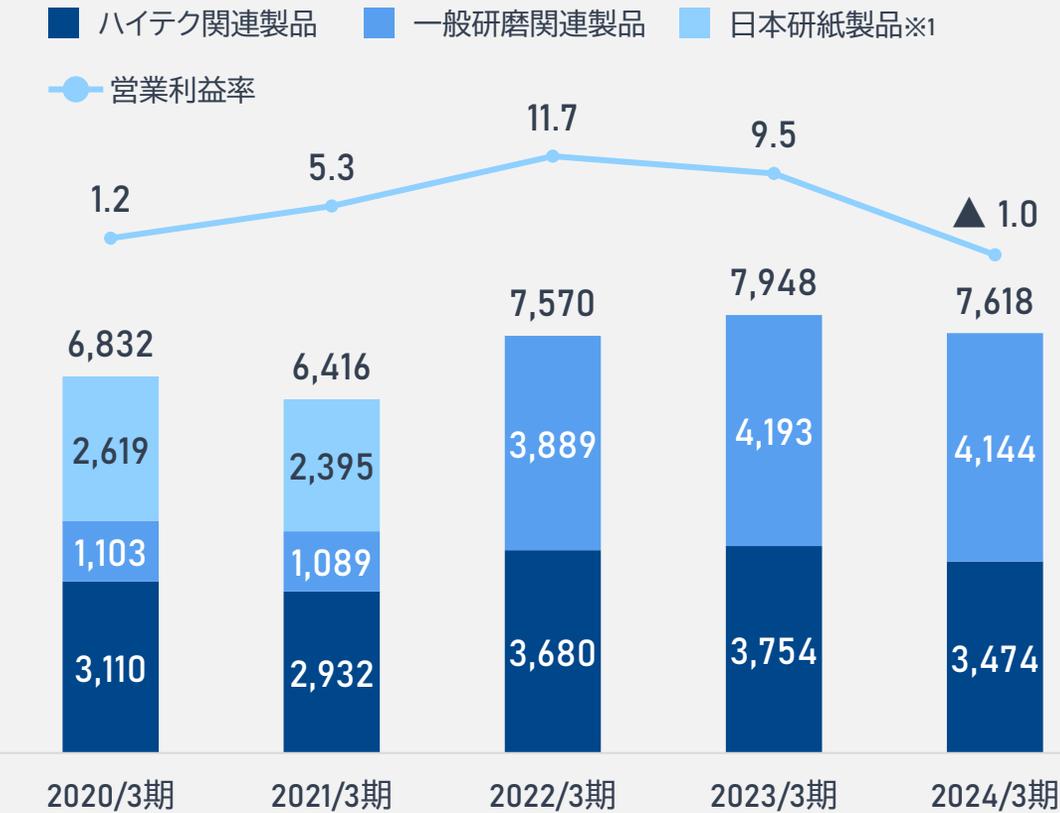


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

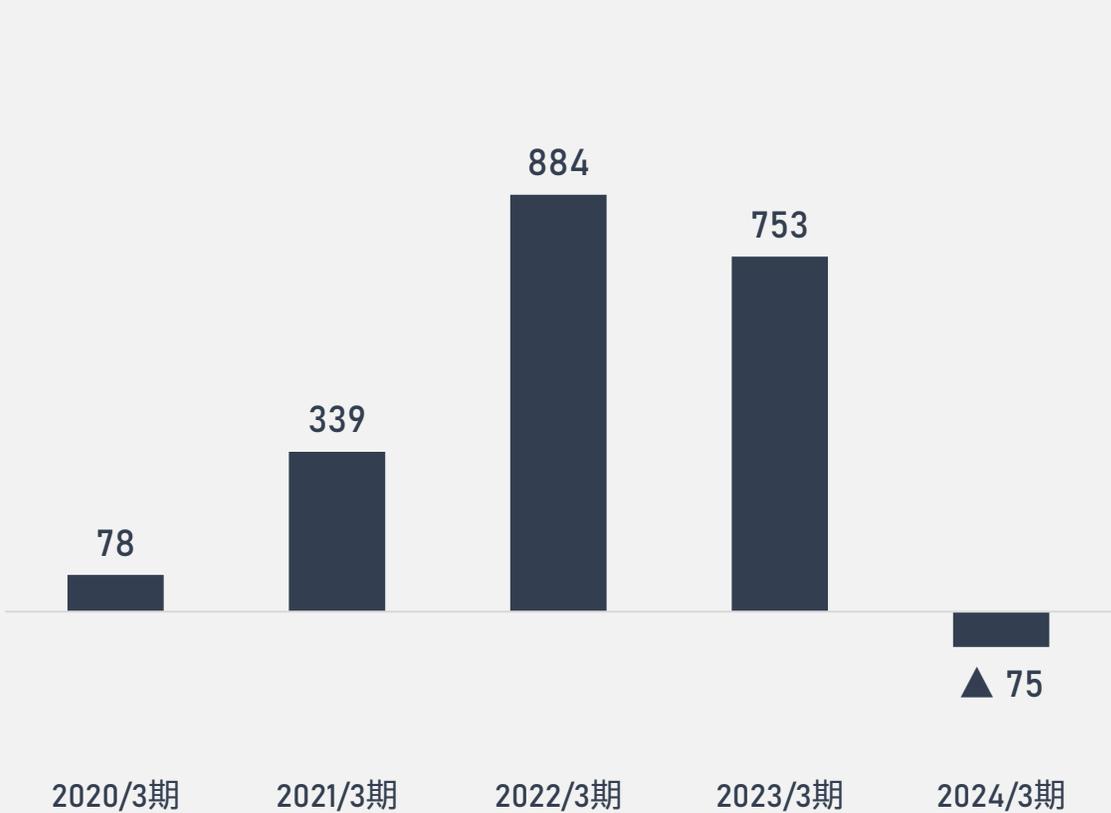
## 02 通期業績推移(製品事業)

- ハイテク関連製品は上半期の低調により、通期で売上高が減少いたしました。一般研磨関連製品は安定的な推移を維持しています。
- 2024年3月期は製品事業に係る棚卸資産評価損等もあり、セグメント営業利益は赤字となりました。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)



※1:日本研紙製品は一般研磨分野ですが、当時は子会社だったため一般研磨関連製品には含めておりません。2021年4月よりMipoxへ統合しております。

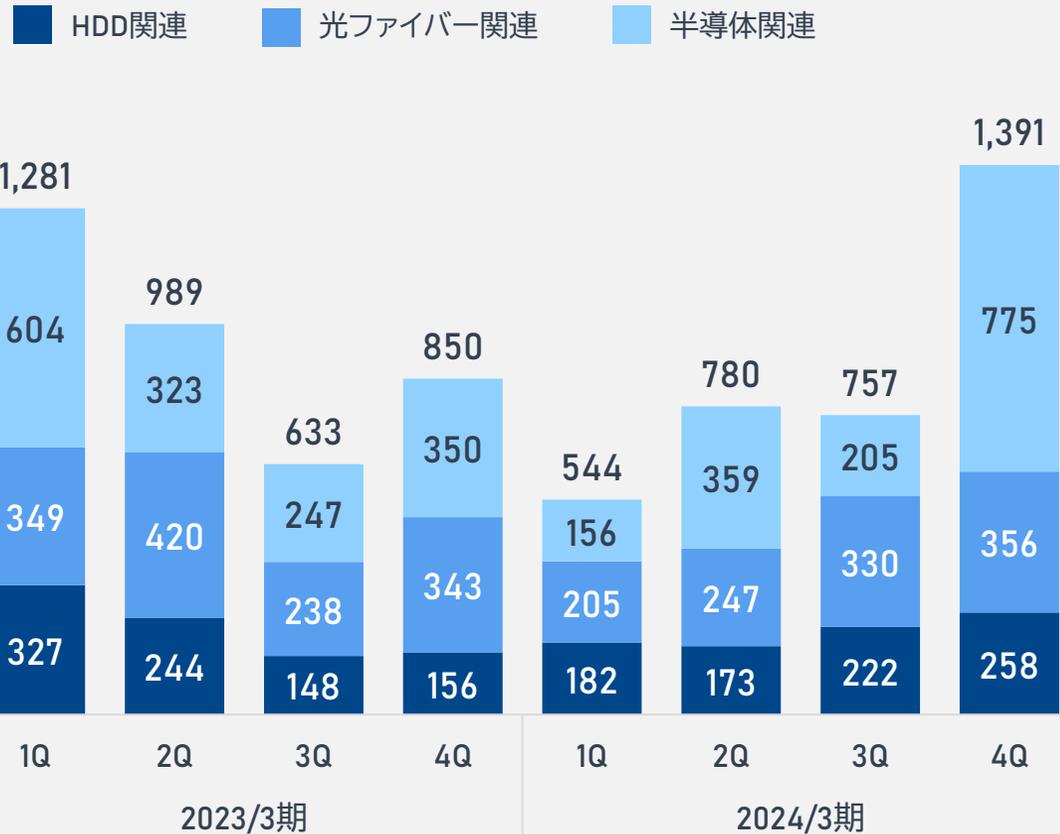
※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。



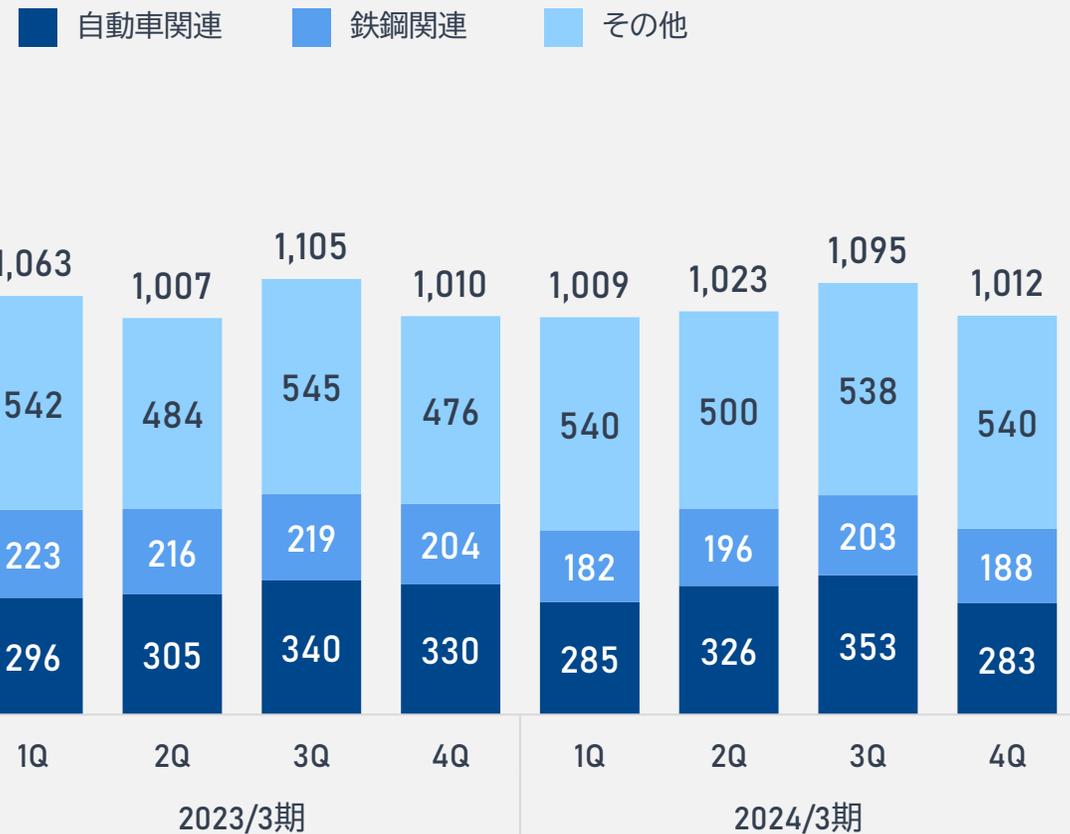
## 02 業績推移(製品事業内訳)

- ハイテク関連製品では、HDD関連および光ファイバー関連が第3四半期から回復傾向です。2024年3月期第4四半期は半導体装置の売上貢献もあり、半導体関連の売上高が増加いたしました。
- 一般研磨関連製品は、海外を中心とした製造需要等の影響により増減がありますが、総じて安定的に推移しています。2024年3月期下期からは一部製品への製造原価上昇分の価格転嫁を開始しています。

ハイテク関連製品(単位:百万円)



一般研磨関連製品(単位:百万円)

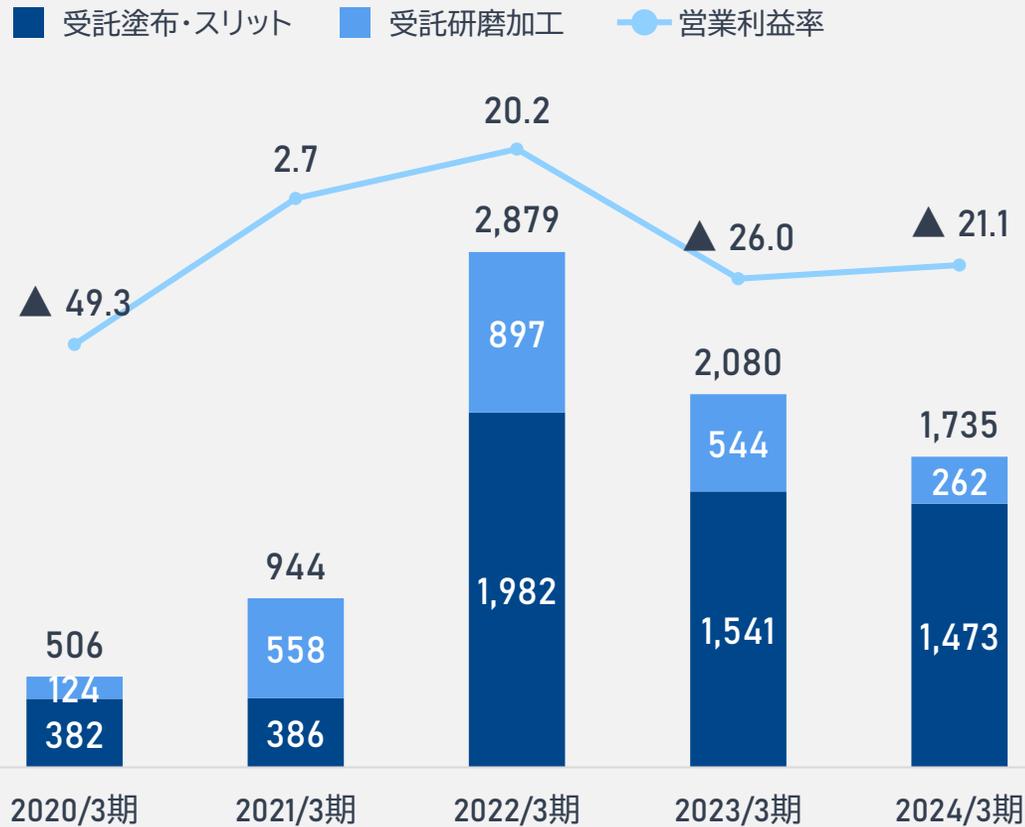


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

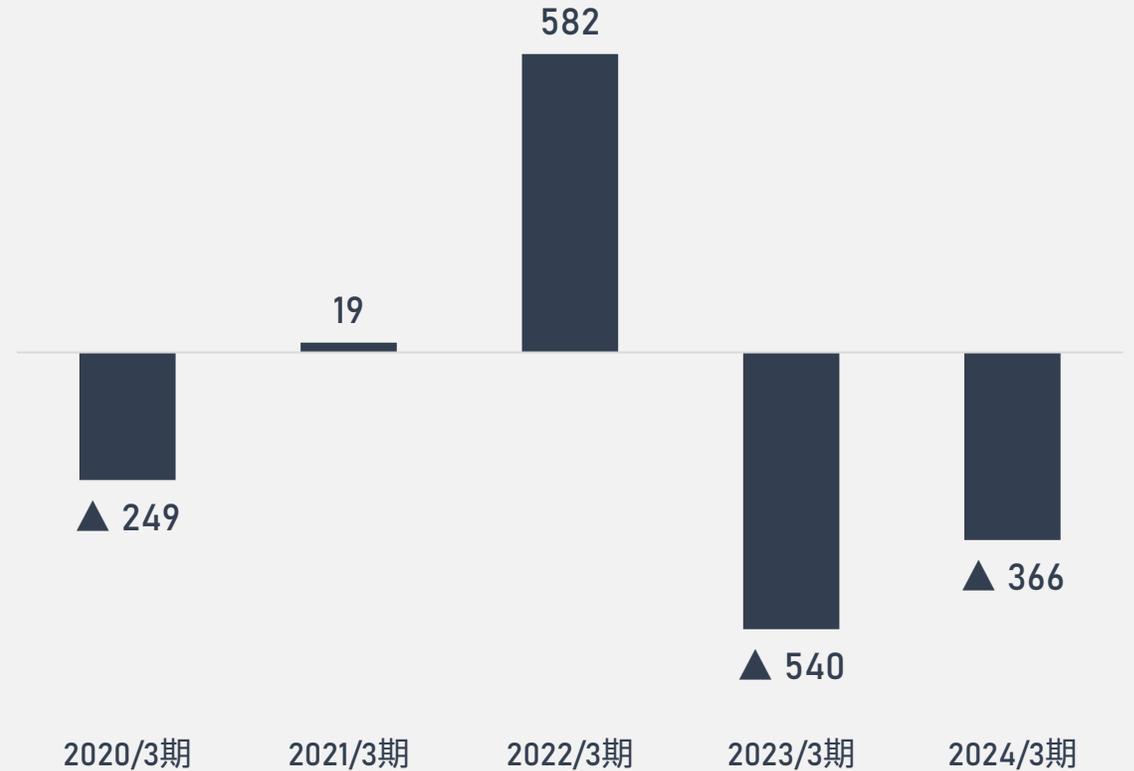
## 02 通期業績推移(受託事業)

- 受託事業はお客様から部材を無償支給でお預かりし、加工しサービス料(売上高)を得る事業です。そのため、固定費割合が高く、一定の受託量と売上高が求められます。
- 受託塗布・スリットおよび受託研磨加工の両方で、主にエレクトロニクス製品向けの受託量が減少し、売上高が減少いたしました。その結果、2024年3月期は前年度同様営業損失を計上いたしました。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)

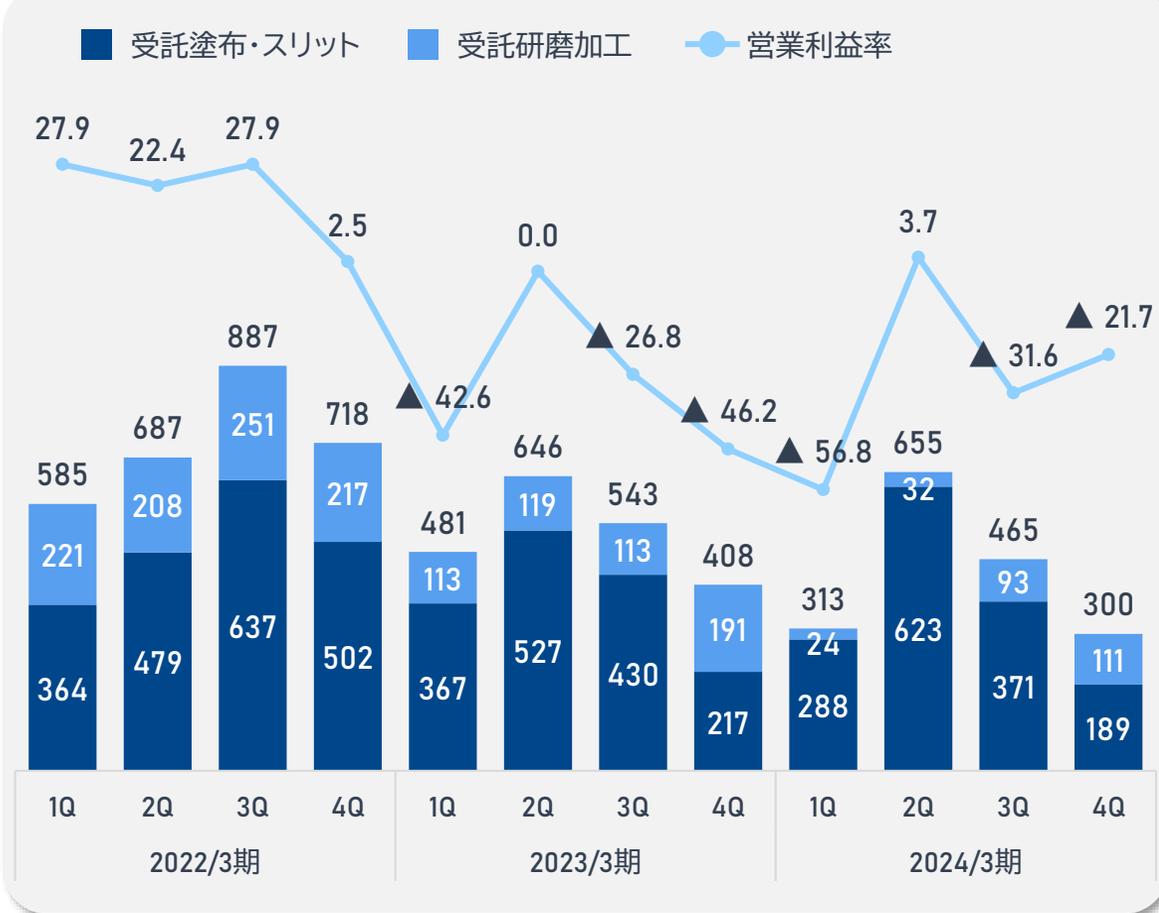


※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

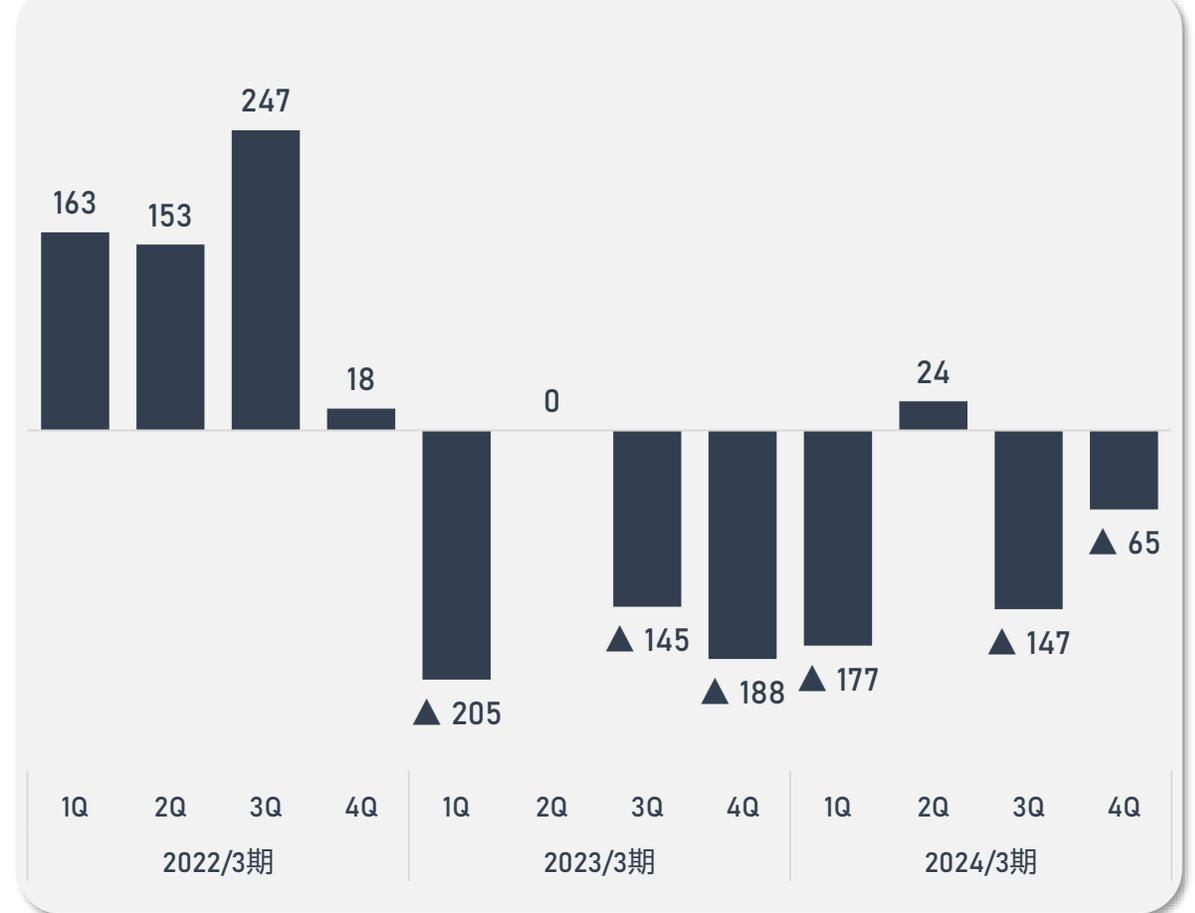
## 02 四半期業績推移(受託事業)

- 受託塗布・スリットはエレクトロニクス製品向け用途が多いため、第2四半期頃をピークとした季節性があります。鹿沼事業所、北杜事業所の両設備の稼働率の向上が必要であり、エレクトロニクス製品向け以外の用途の顧客獲得を推進しています。
- 受託研磨加工は難易度の高い先端材料の受託量等が増加しておりますが、その他量産となる受託案件が乏しく、売上高は減少傾向でした。なお、第3四半期から連結子会社となった大久保鉄工所の売上高が加算されています。

売上高・営業利益率(単位:百万円・%)



営業利益(単位:百万円)



※業績数値の百万円未満の端数の扱いにより、若干の差異が生じる可能性があります。

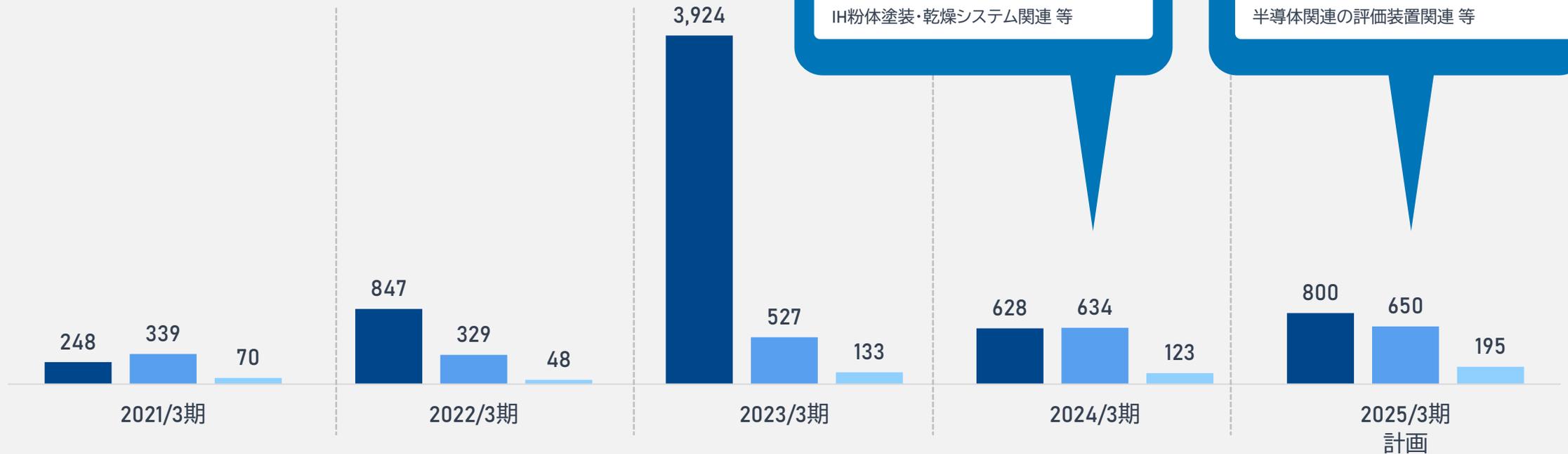
(単位:百万円)	2023/3期末	2024/3期末	増減額	備考
流動資産合計	9,032	8,773	▲258	
現金及び預金	2,613	2,692	+78	
売上債権※	2,385	3,063	+678	第4四半期の売上高増加によるもの
棚卸資産	3,127	2,670	▲456	第4四半期の売上高増加によるもの
その他	908	347	▲561	税金関連還付金受領による減少
固定資産合計	7,162	7,203	+41	
有形固定資産	6,663	6,596	▲67	京都工場の売却、インドの工場取得等含む
資産合計	16,195	15,977	▲217	
流動負債合計	5,065	4,930	▲135	
支払手形及び買掛金	793	679	▲113	
短期借入金(社債含む)	2,930	3,032	+101	
未払金	664	737	+73	
その他	376	165	▲211	
固定負債合計	3,131	3,563	+431	
長期借入金(社債含む)	2,867	3,141	+273	長期借入による財務基盤の安定化
負債合計	8,197	8,493	+295	
純資産合計	7,997	7,484	▲513	
負債純資産合計	16,195	15,977	▲217	

※売上債権は受取手形、売掛金、電子記録債権を合計し、棚卸資産は商品および製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を合計しております。

※増減算出後、百万未満切捨て

(単位:百万円)

- 設備投資額
- 減価償却費
- 研究開発費



設備投資額の主な要因

- インド子会社の新工場の取得
- 福山事業所の太陽光発電システムの導入
- ウェーハ接合装置等の取得

研究開発費の主な要因

- 受託研磨加工領域のパワー半導体やウェーハの接合技術関連
- IH粉体塗装・乾燥システム関連 等

設備投資額の主な予定

- IH粉体塗装システム関連
- 大久保鉄工所の新規設備導入
- 鹿沼事業所の太陽光発電システムの導入

研究開発費の主な予定

- ハイテク関連製品の製品開発
- 半導体関連の評価装置関連 等

## 2025年3月期

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2024年5月15日	1Q	新製品「SiC (炭化ケイ素)8 インチ半導体ウェーハ専用研磨装置」の提供開始に関するお知らせ	P22
2024年4月26日	1Q	レーシングドライバー根本悠生選手とスポンサー契約締結のお知らせ	P23

## 2024年3月期

リリース日	該当四半期	タイトル	詳細
2024年3月25日	4Q	福山事業所の太陽光発電設備設置に関するお知らせ	P21
2024年3月4日	4Q	NEDO採択事業のステージゲート通過のお知らせ	<a href="#">別途資料</a>
2024年2月13日	4Q	配当予想の修正(無配)に関するお知らせ	<a href="#">別途資料</a>
2024年1月29日	4Q	高精度アライメントシステムを採用した常温接合加工サービスを開始	<a href="#">別途資料</a>
2024年1月23日	4Q	海外子会社の移転に関するお知らせ	<a href="#">別途資料</a>
2023年12月26日	3Q	足利銀行による「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」評価書が公開されました	<a href="#">別途資料</a>
2023年11月24日	3Q	海外子会社の工業用地および建物の取得に関するお知らせ	P21
2023年10月31日	3Q	有限会社大久保鉄工所の全株式の取得(子会社化)に関するお知らせ	P21
2023年10月30日	3Q	Mipox京都工場閉鎖のお知らせ	<a href="#">別途資料</a>
2023年10月24日	3Q	IH(高周波誘導加熱)粉体塗装システム ラボ新設	<a href="#">別途資料</a>
2023年8月10日	2Q	名古屋大学との共同研究成果が論文として掲載されました	<a href="#">別途資料</a>
2023年4月27日	1Q	米国インターナショナル・テスト・ソリューションズ社の契約解除に関するお知らせ	<a href="#">別途資料</a>

## インド工場の動き

2023年11月23日、海外子会社であるMIPOX Abrasives India Pvt. Ltd.にて新工場用地および建物を取得し、移転いたしました。

これまでの工場では、事業拡大に伴う生産能力の増強が難しい状況でしたが、新たに取得した工場は現工場に比べて2倍以上の広さとなります。福山事業所から一部製造ラインの移設を予定しております。



## 環境への取り組み(太陽光パネル)

2023年2月に太陽光パネルを増設した北杜事業所に続き、福山事業所にも設備を導入いたしました。

再生可能エネルギー源の利用により、電力コストの削減、CO2排出の削減を実現し、長期的な環境配慮を考慮した経営を推進してまいります。



## 鹿沼事業所集約、NEDO※ 採択事業の設備の導入完了

2023年4月に移転した鹿沼事業所への業務集約は京都工場から反射材事業の移設、スガ・コーディングス社より事業譲渡を受けた粉体塗装事業の製造環境を整備いたしました。近隣にはM&Aを実施した大久保鉄工所があり、これにより鹿沼事業所は重要な拠点となりました。

NEDOより採択を受けた研究開発環境に関わる機械設備の導入も完了いたしました。(P43参照)



※NEDO=国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

## 事業領域拡張について

### 【大久保鉄工所の取り組み】(P41参照)

2023年10月、金属パーツの精密研磨加工を専門とする、有限会社大久保鉄工所の全株式を取得し、子会社化いたしました。

これまでの研磨加工サービスに於いてハイテク分野のみの対応から、自動車部品や医療機器などの一般研磨分野の参入も可能となりました。

今後は人員補充と設備増強を予定しております。



### 【IH(高周波誘導加熱)粉体塗装事業への取り組み】

2023年3月、株式会社スガ コーディングスのコーティング事業を譲り受けました。IHを活用したコーティングラインの企画・設計・開発・販売を展開し、溶剤不使用のコーティング技術の導入支援を行っています。

この技術は有機溶剤による従業員の健康被害や環境汚染などの課題解決のソリューションとなり得るものです。2023年10月に実証実験ラボの開設を機に、引き続き受注活動に注力してまいります。



### -粉体塗装技術の活用-

粉体塗装技術を活かした研磨製品の製造開発にも取り組んでいます。



粉体塗装技術で製造した研磨製品

## 新製品「SiC (炭化ケイ素)8 インチ半導体ウェーハ専用研磨装置」の提供開始

精密研磨分野で培ってきた強みを活かし、受託研磨加工サービスを強化する一貫として、SiC8インチ半導体ウェーハのノッチ/外周に特化した専用仕様の研磨装置を開発し、Mipoxの研磨フィルムを使用することで安定した面取り加工を施せる工法を確立いたしました。国内外に問わず引き合いが急増しているSiC8インチ半導体ウェーハの安定供給に貢献し、SiC8インチ半導体ウェーハのニーズにお応えしてまいります。

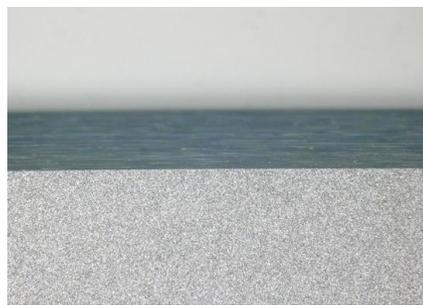
【SiCウェーハ エッジ部(外周部)】



面取り加工中



面取り加工前



面取り加工後

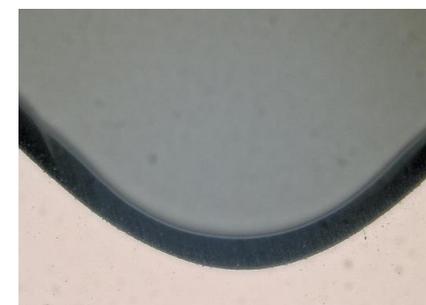
【SiCウェーハ ノッチ部】



面取り加工中



面取り加工前



面取り加工後

## レーシングドライバー 根本悠生選手とスポンサー契約を締結

我々モノづくりメーカーと同じ“ファクトリー”の肩書を目指し奮闘する姿と情熱に触れ、我々もまた自分たちの挑戦にその姿を重ね、このたびのスポンサー契約に至りました。

我々の事業と根本選手の活動が共に進むことで、モータースポーツと自動車産業全体の発展に寄与することを目指しています。

### 【根本選手プロフィール】

名前 根本 悠生（ねもと ゆうき）

生年月日 1996年9月22日(27歳)

出身地 東京都

直近の  
戦歴/受賞歴 2021年 International GTOPEN Championship プロクラス4位  
2022年 Campionato Italiano GT Enduranceシリーズチャンピオン  
2023年 Fanatec GT World Challenge Europe Powered  
by AWS Sprint Cup Silver フル参戦

コメント Mipox様とのスポンサー契約を通じて、私のモータースポーツ活動だけでなく、自動車産業全体の発展に寄与する素晴らしい機会にできることを非常に楽しみにしております。このパートナーシップが新たな展開をもたらし、自動車産業全体の進化に寄与できることを誇りに思うとともに、更なる世界での活躍に向けより一層努力してまいります。



バルクウェーハ完成

半導体ウェーハ完成

半導体チップ完成

単結晶引上工程  
NEDO 先導研究  
プログラム

大型SiC結晶(イン  
ゴット)に対する欠  
陥・内部歪の観察解  
析技術(終了)

評価技術

バルクウェーハ製造 工程

バルクウェーハ加工

半導体製造 工程

半導体 前工程

素子形成・配線形成・ウェーハ特性検査  
プローブカード向け クリーニングシート製品

製品事業

評価技術

名古屋大学共同研究、NEDO 若手研究者発掘支援  
事業。半導体製造の生産性を向上させるキラー欠  
陥。自動検査システムの開発

半導体 後工程

組立・検査

実装

PC基板  
専用研磨材

省電力化、省スペース化  
=高密度化(積層技術)  
例)生成AI、次世代半導体  
アライメント機材あり(位置決め接合)

製品事業

受託事業

受託事業

複雑な工程を当社が一括管理。ワンストップソリューション

■ 当社が関わる工程

バルクウェーハ加工 工程

加工技術

NEDOグリーンイノベーション(GI)基金  
大口径SiCウェーハ加工ラインの開発、ウェーハ加工工数の削減

インゴット  
外周  
研削加工

スライス  
加工

ベベル加工  
(外周面取り)

ウェーハ  
研磨装置  
ベベル

ラップ加工  
(粗研磨)

スラリー

ポリッシング  
(鏡面表面)

洗浄

検査

NEDOグリーンイノベーション  
(GI)基金  
溶液法におけるSiC結晶の  
評価技術確立。大口径ウェーハ  
観察装置の開発

評価技術

製品事業

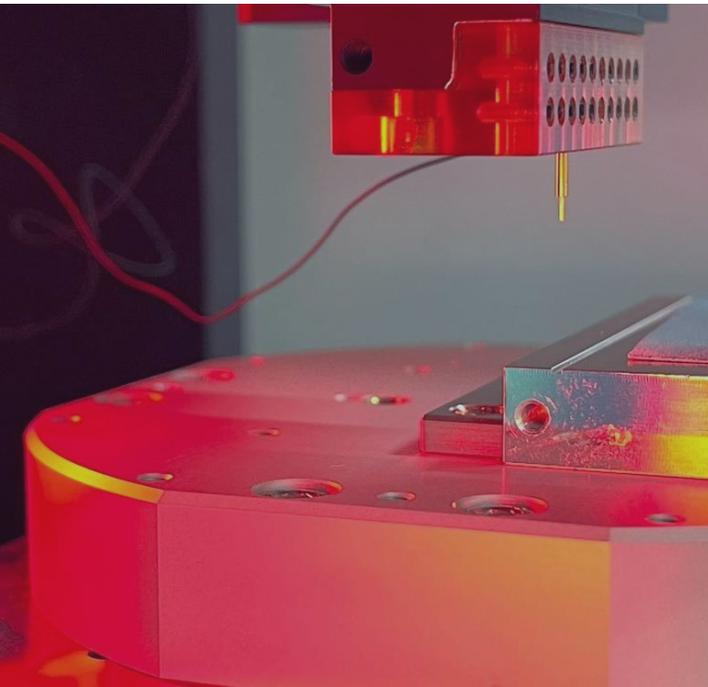
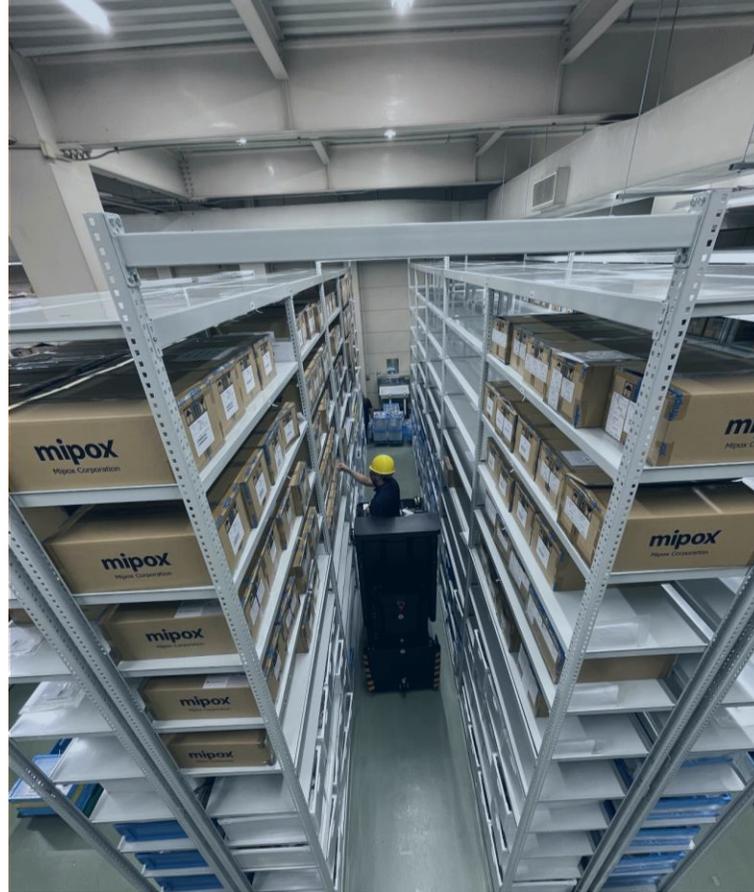
接合加工

エッジ研磨

平面研磨

次世代半導体(パワー半導体)  
高出力パワーモジュールの実現  
熱設計(ヒートシンク)接合研磨加工サービス

# Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期 通期実績
- 03 通期業績見通し**
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
2025年3月期予想(A)	10,000	300	300	200
2024年3月期実績(B)	9,354	▲442	▲186	▲409
増減額(A-B)	+646	+742	+486	+609
増減率	+6.9%	-	-	-

※増減算出後、百万未満切捨て

## コメント

- 2023年3月期下期からPC・タブレット製品等の電子デバイス市場やデータセンター向け投資の抑制が長期化し、2024年3月期上半期まで関連製品が低迷いたしました。下半期から回復基調にあります。上半期の減収減益の影響が大きく2024年3月期は通期で各段階利益は赤字となりました。
- 2025年3月期は製品事業のハイテク関連製品で一定の回復が見込まれます。但し、2022年4月に取得した鹿沼事業所の製造能力を活かした受託事業の売上高確保には時間を要する想定です。そのため、2025年3月期の売上高は対前年比で6.9%増加の100億円を見込んでいます。
- ECを活用した販売チャネルの多様化や製造DXでの工場の自動化・省力化等を通じ、コストや利益率の構造的な改善を進めて参ります。また、2023年11月にグループ会社となった有限会社大久保鉄工所の利益貢献等もあり、2025年3月期の営業利益は3億円を想定しています。受取賃借料の計上がある一方、金利の上昇や不安定な為替動向もあり、経常利益は3億円、親会社株主に帰属する当期純利益は2億円を予想しております。

### ハイテク関連製品

- 2024年3月期下半期から光ファイバー関連、ハードディスク関連および半導体関連製品が回復傾向です。2025年3月期通期においても一定の回復を見込んでいます。
- 光ファイバー関連市場は米国を中心とした需要の増加が見られます。ハードディスク関連は顧客の在庫調整が終わり、生成AIの普及を起点としたデータセンター向け投資の戻りが期待されます。また、活況な半導体需要に関連し、当社の半導体向け製品のプローブカードクリーニングシートの販売促進を進めてまいります。

### 一般研磨製品

- 全般的に底堅い需要がある製品用途であり、引き続き売上高は安定的に推移することを見込んでおります。一方、原材料やエネルギー費用の高騰は継続し、人件費の増加もあるため、過年度と比較すると利益率は低下傾向です。これに対し、各種製品の値上げを進めています。
- 長期に渡る経済成長が期待されるインドで新工場を取得し、従来の自動車関連用途向け研磨製品に加えて、新たに橋梁や建設関連向けの研磨製品の開発と生産を進めまいります。一方で、自動車関連製品では、中国を中心とした製造需要の減少による影響も想定されます。
- 2023年3月に取得した溶剤フリーのIH粉体塗装事業の営業展開をパートナー企業と共に進めており、2025年3月期中の売上貢献を進めます。また、当該技術を一般研磨関連製品へ転用し、脱炭素に貢献する画期的な溶剤レス製法による新製品を展開予定です。

### 受託塗布・スリット

- 新規顧客開拓を進め、試作件数が増加しておりますが、量産の獲得には時間を要する見込みです。
- 既存の受託案件においては、エンド製品の需要動向から受託量の減少も予想されます。代替する新たな用途の受託塗布・スリット案件の獲得を進めてまいります。

### 受託研磨加工

- 受託量が減少した2024年3月期は、オウンドメディアである「研磨ラボ」や国際学会であるICPTでの露出を通じ海外顧客からの認知度向上や新規の受託先開拓を進めてまいりました。
- 高難度の先端材料加工の実績を積み上げており、GaN(窒化ガリウム)縦型デバイスの実現に向けた接合案件等が増加しております。さらに、GaN等に加えてAlN(窒化アルミニウム)単結晶材料が次世代半導体材料として注目度を上げており、その加工依頼が増加しております。
- ダイヤモンドを代表とした次世代半導体ウェーハの研磨材(スラリー・研磨フィルム)や専用研磨装置の開発を進めています。また、SiCでは8インチウェーハからノッチが採用されるため、オリフラに比べて難易度の高いノッチ研磨が課題となっており、当社の研磨フィルム方式の優位性が高く、専用研磨装置・研磨フィルムを拡販して参ります。
- 高精度アライメントシステムを採用した常温接合加工サービスを開始し、MEMS(微小電気機械システム)、ハイブリッド接合、半導体向け3次元積層等の先端技術への案件の獲得に努めてまいります。
- 新たにグループ会社となった大久保鉄工所の金属精密研磨加工領域の規模拡大を引き続き進めてまいります。

## 年間配当

2023年3月期

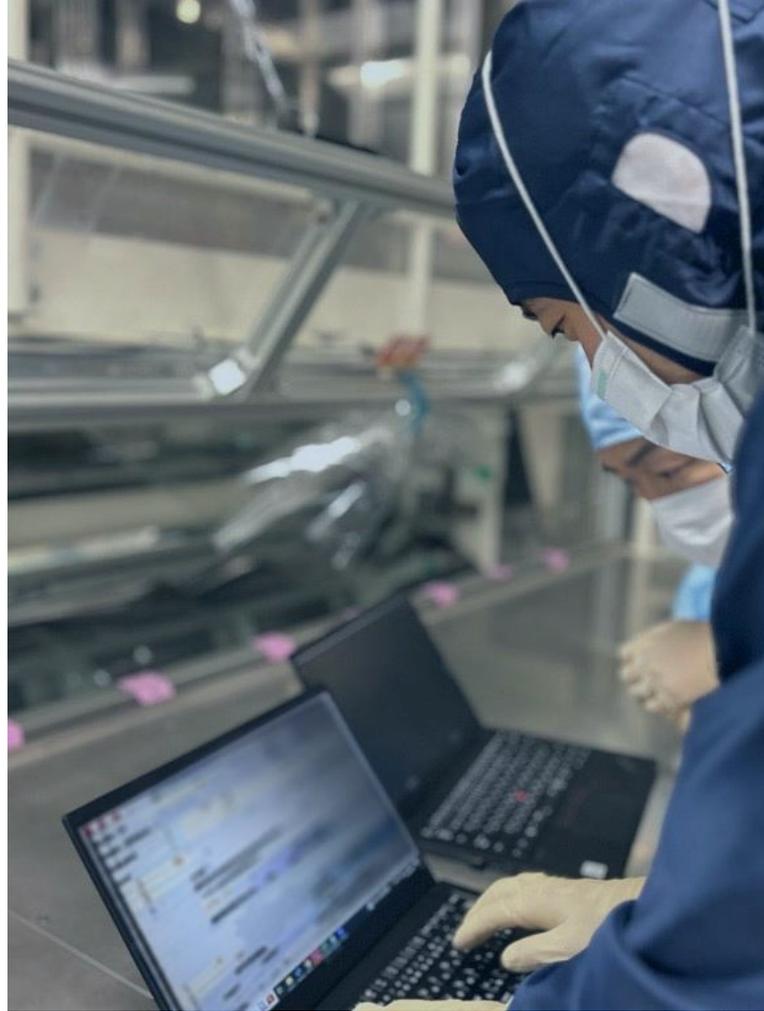
10円

2024年3月期

無配

将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様に対しては安定配当を目指しつつ、業績等を勘案して、適正な利益還元に努めておりますが、当初予想より大幅に下回る結果となっております。そのため、誠に遺憾ではございますが、2024年3月期の期末配当の実施を見送らせていただくことといたしました。

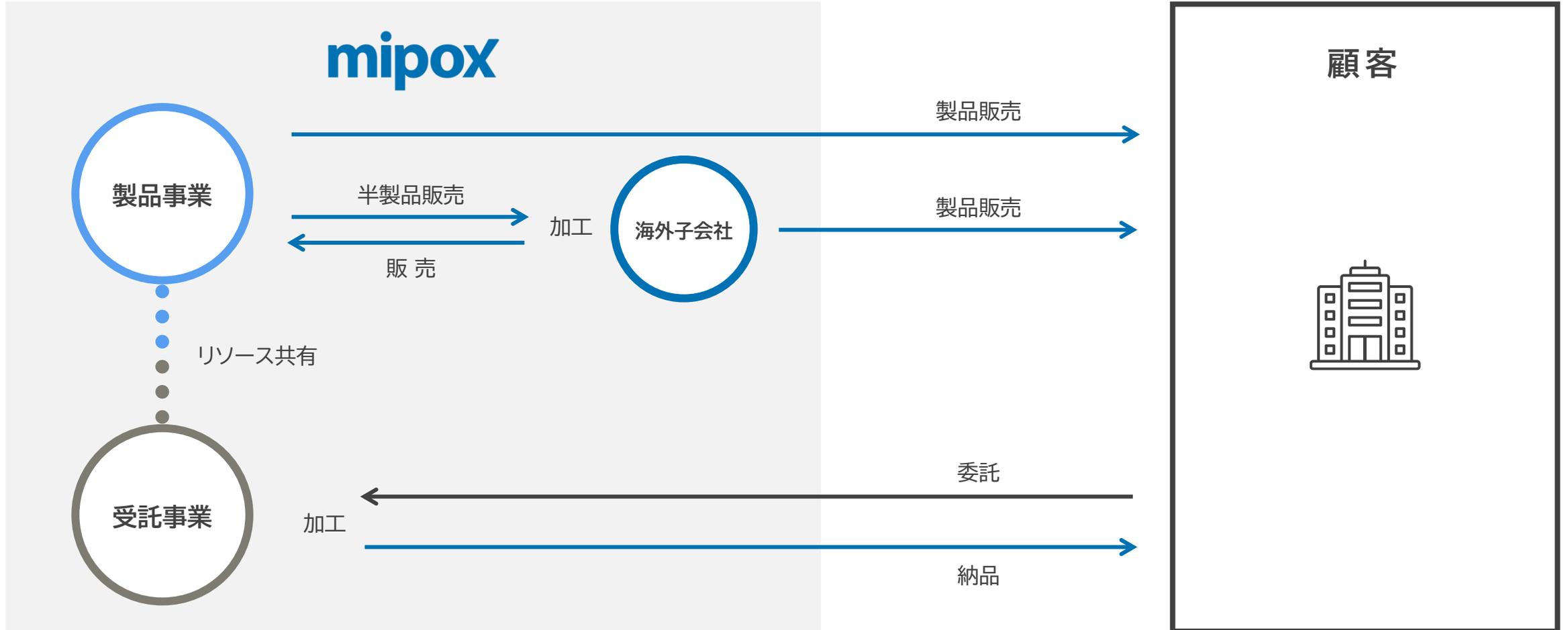
# Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期 通期実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容**
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

## 04 事業系統図

- 海外工場での加工を経ることにより、日本のみならず工場が存在するよりも様々な製品を効率よく製造しております。海外向けに販売も行っております。
- 顧客からの委託を受けて加工も行っており、自社製品のみならず顧客の要望に合わせたサービス・製品も提供しております。



## 製品事業

研磨材の開発・製造・販売を行っております。  
超精密研磨から一般研磨、装置や反射材など、世界中の幅広い用途に向けて  
当社製品を提供しております。



研磨フィルム



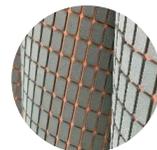
液体研磨剤



研磨関連製品



研磨布紙製品



研磨砥石製品



研磨周辺機器



検査装置

再帰性反射材  
(Ref Lite)

ヤスリ製品



IH粉体塗装

## 受託事業

## 【受託研磨加工】

半導体ウェーハをはじめとする材料を顧客より預かり、弊社が保有する設備  
(研磨装置、洗浄機、検査装置)と独自の研磨材を用いて、要望に沿った研磨  
加工を提供しております。

## 【受託コーティング・スリット】

顧客の基材(フィルム等)や塗料材を預かり、弊社が保有する設備(調合、  
コーティング、スリット)を用いてフィルム化、裁断を行っております。



塗布製品



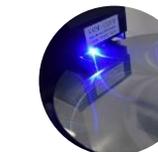
研磨加工



スリット加工

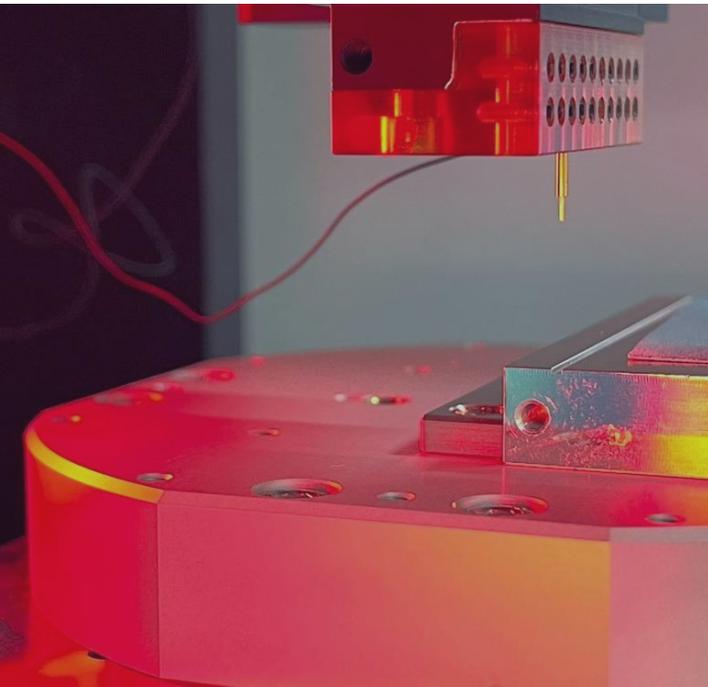
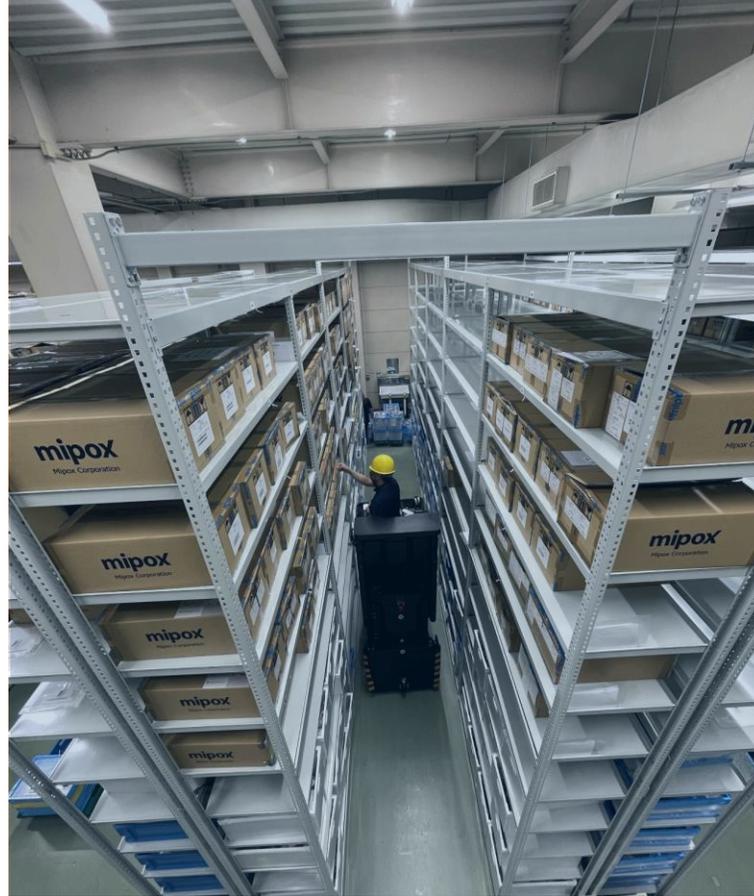


常温接合加工



検査

# Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期 通期実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉**
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

1 事業間で発揮されるシナジー効果

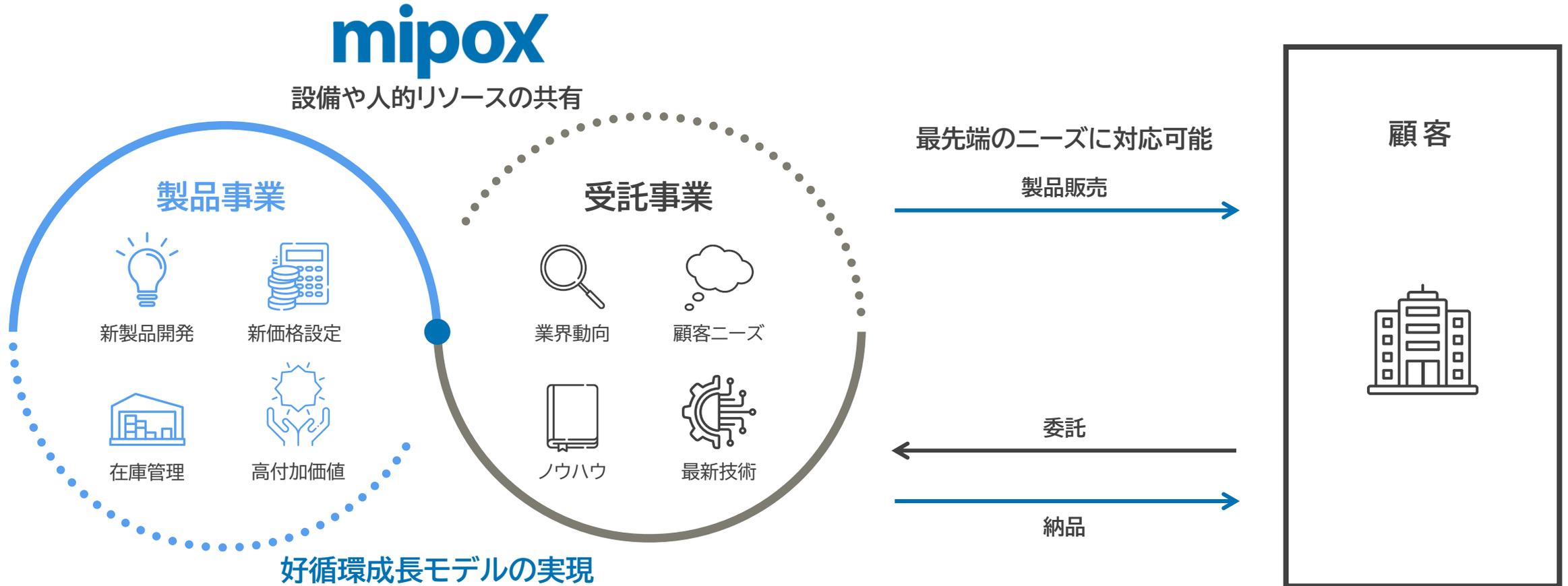
2 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

3 スマートファクトリー

## 05 競争力の源泉① 事業間で発揮されるシナジー効果

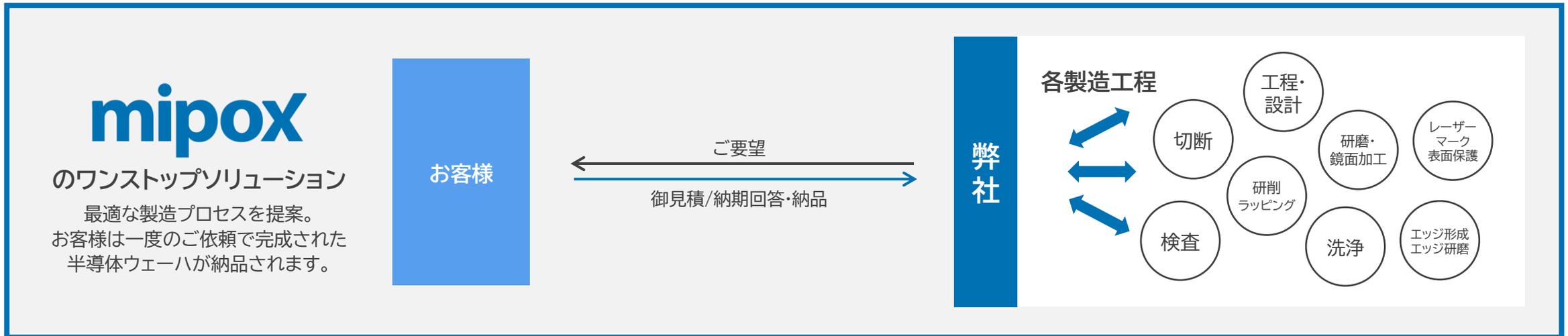
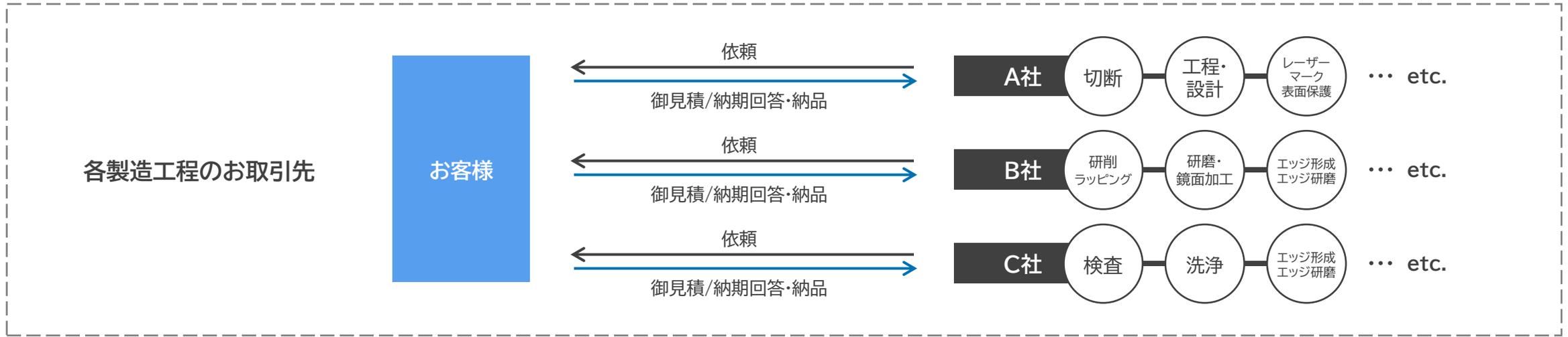
- 製品事業と受託サービス事業では設備や人的リソースを共有しており、技術やノウハウの蓄積に役立っております。
- 蓄積された技術やノウハウは高付加価値のある製品やサービスの創出に活かされ、顧客の多様な要望を実現する源になっております。

### 製品事業と受託事業の共有型リソース



## 05 競争力の源泉② 顧客の要望に合わせた高品質な製品の提供

- 製品製造と受託加工ができるため、顧客の理想に合わせた製品の作成、きめ細やかなサービスの提供が可能です。
- 各製造工程において異なる取引先との煩雑なやりとりを当社がワンストップで提供しており、顧客の要望が1つの窓口で完結いたします。



# 05 競争力の源泉③ スマートファクトリー

- IoTとAIを活用し連携させることで、可視化しづらい部分の改善に役立つデータを収集しております。
- 工場のDX化により、さらなる効率化・高品質化を目指します。

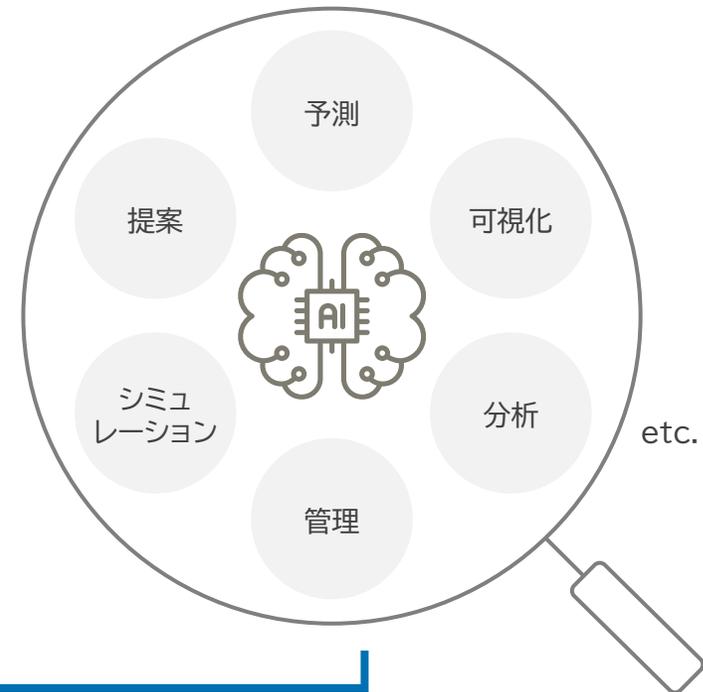
## IoT

あらゆる機器を連携させ、様々なデータを収集・蓄積



## AI

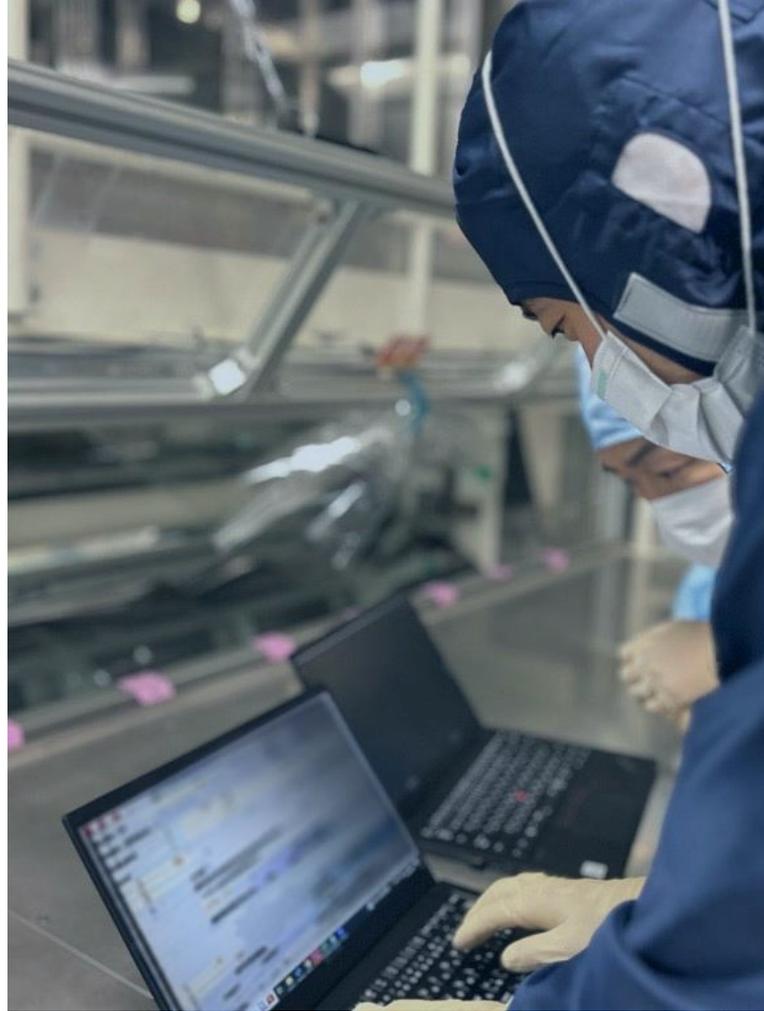
IoTで集めたデータを分析して課題を見える化



業務プロセスの改革

品質・生産性の向上

# Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期 通期実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略**
- 07 Appendix

1 製品・受託事業領域の拡張

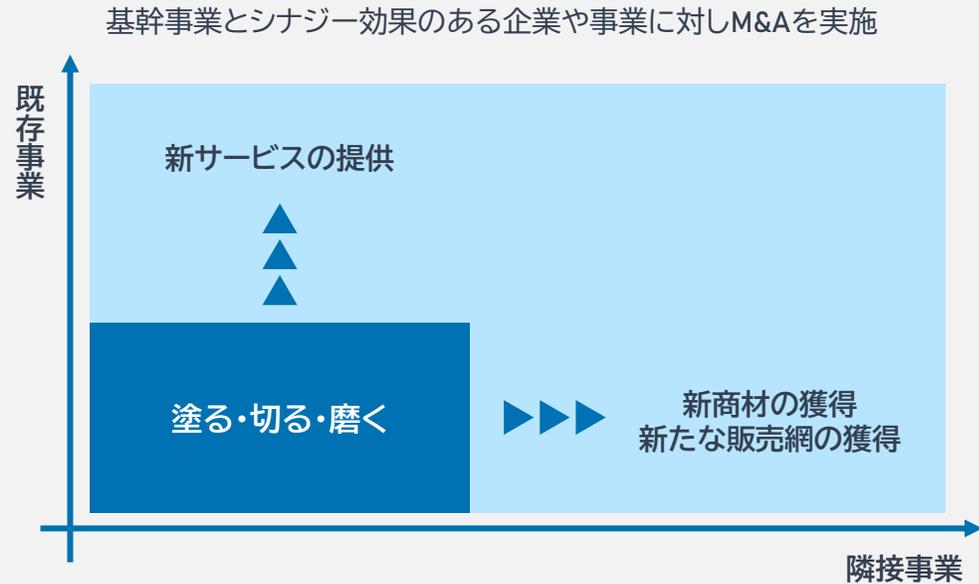
2 鹿沼事業所の量産体制構築

3 産官学プロジェクトへの参画

## 06 成長戦略① 製品・受託事業領域の拡張

- 当社の基幹技術「塗る」「切る」「磨く」の事業領域を拡大するための打ち手として、M&Aを実施してまいりました。
- 今後も製品・受託事業領域の拡張を行ってまいります。

### M&Aに対する基本的な考え方



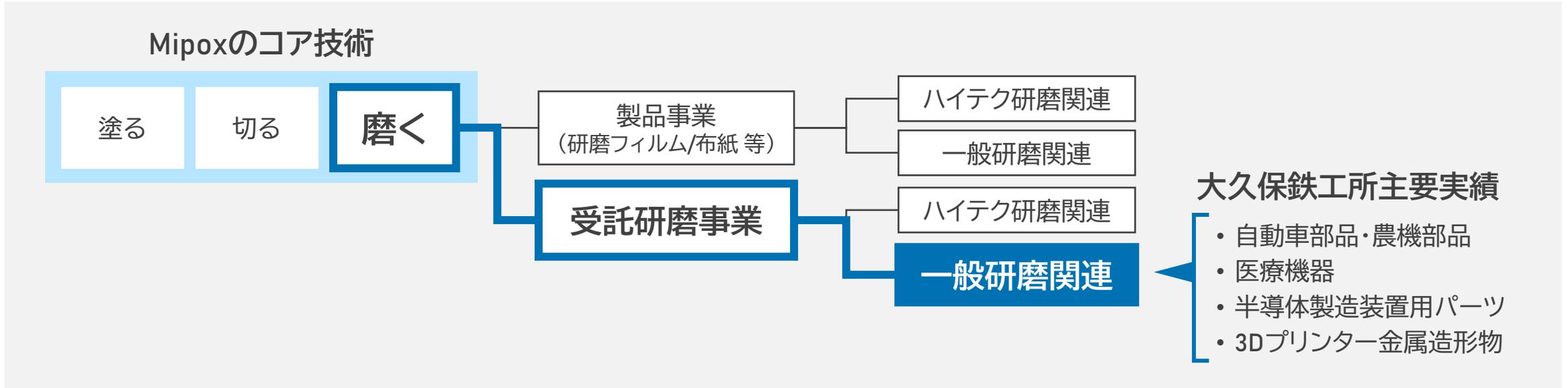
### これまでのM&A実績

 <p>Ref Lite Color Your Style.</p> <p>反射材製品、精密研磨フィルム等の製造・販売 (2015年)</p>	 <p>Nikken</p> <p>研磨布紙及びその他研磨材製商品の製造・販売 (2016年)</p>	 <p>ORIENT</p> <p>フレキシブル・超高品質なヤスリの開発・製造 (2021年)</p>
 <p>MISUMI</p> <p>研磨ディスクの製造・販売 (2022年)</p>	 <p>スガ コーディングス</p> <p>有機溶剤不使用のコーティング事業 (2023年)</p>	 <p>大久保鉄工所</p> <p>金属パーツの精密研磨加工 (2023年)</p>

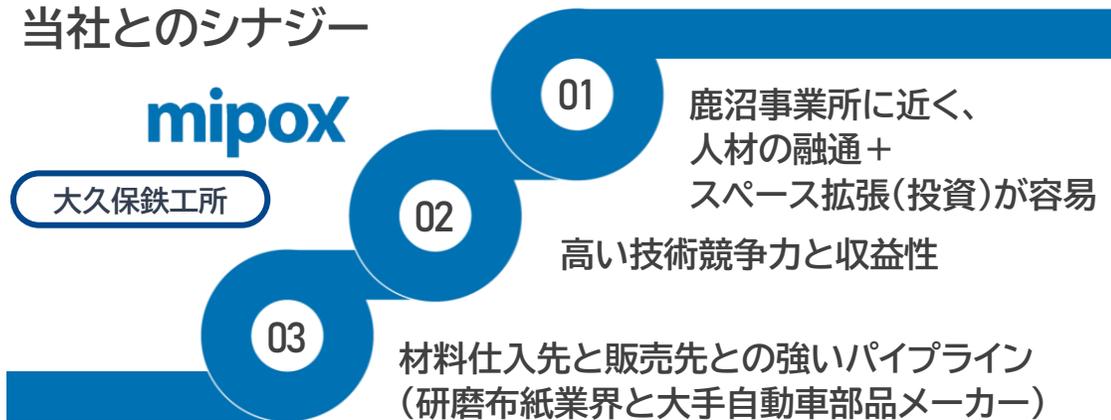
多様化するニーズに、迅速且つ的確に対応できる体制の構築

## 06 成長戦略① 製品・受託事業領域の拡張 -大久保鉄工所の参画-

- 2023年10月31日に大久保鉄工所をM&Aにて取得、これにより当社の主要事業すべてにおいて一般研磨用途の参入が可能となり、さらなる対象市場の拡大と新規顧客の獲得が期待されます。



### 当社とのシナジー



### 今後の展望

- 受託研磨事業の対象市場拡大  
(自動車・農機・医療・3Dプリンター業界など)
- Mipoxの営業ネットワークを活用した新規顧客の獲得



## 06 成長戦略② 鹿沼事業所の量産体制構築

- 2023年4月より本社を東京オフィスから鹿沼事業所に移転し、本格稼働を開始いたしました。
- 今後、計画的に人員・設備・機械の増強を行いながら、更なる生産能力の拡大に努めてまいります。

### 鹿沼事業所

敷地面積:約60,000㎡  
延床面積:約46,000㎡

### 取得日

2022年4月1日

### 取得目的

受託事業の生産能力拡大  
事業成長のための場所確保  
BCPの観点から生産体制のリスク分散



受託研磨加工

スリット工程

塗布工程

環境配慮設備

ダイカット工程

物流

### 鹿沼事業所の稼働状況

- 受託塗布・スリットの稼働を開始
- タイ子会社、京都工場からの生産移転
- (株)スガコーディングスのIH塗装事業の稼働開始
- 東の物流拠点としての機能を集約
- 使用面積増加も可能(未使用エリアは他社へ貸与中)

### 研磨ラボの活用

顧客と一体で研磨プロセス、製品開発を進められる体制を構築し、初期ニーズの把握を行い、付加価値が高く迅速な製品提供を展開予定



## 06 成長戦略③ 次世代半導体プロジェクト (当社参画のプロジェクト一覧)

- 3つのNEDOプロジェクトに参画しております(うち1プロジェクトはすでに終了)。
- 加工技術と評価技術の確立においてさまざまな組織と協力し、国主導のプロジェクトを進めております。

### PROJECT 01

#### NEDOグリーンイノベーション基金事業 -次世代デジタルインフラの構築-

オキサイドを幹事会社として(株)UJ-Crystal、国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、アイクリスタル株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所が参画

- 最初の2年の委託事業を当初想定通りの成果で終了し、本年度から助成期間に移行
- 今期はパイロットライン各装置の立上げ・工数削減・シミュレーション技術の構築を目指し、検査装置の量産化検討を実施

#### 加工技術

##### 大口径SiCウェーハ加工ラインの開発

8インチ対応SiCウェーハ加工、パイロットラインの構築

##### ウェーハ加工工数の削減

加工シミュレーションの検討と削減工程候補の抽出

#### 評価技術

##### 溶液法におけるSiC結晶の評価技術確立

溶液法SiCに適した光学系の最適化とそれに基づく装置設計

##### 大口径ウェーハ観察装置の開発

8インチウェーハに対応した装置使用の検討と設計

### PROJECT 02

#### NEDO官民による若手研究者発掘支援事業

名古屋大学(原田俊太准教授)

- デバイスメーカーとの連携によりデバイス不良との相関を確認し、デバイスキラー欠陥検出もしくはウェハ品質スクリーニングが可能な量産装置の構築を目指す

#### 評価技術

##### 半導体製造の生産性を向上させるキラー欠陥

自動検査システムの開発 [2023年8月論文発表](#)

### PROJECT 03

#### NEDOマテリアル革新技術先導研究プログラム

電力中央研究所・名古屋大学(宇治原徹教授)・理化学研究所

2022年度末に終了

- 2022年度末に終了し、製品化に向けた開発を継続

#### 評価技術

##### 大型SiC結晶に対する欠陥・内部歪の観察解析技術

SiCインゴット検査装置の開発

## 06 成長戦略③ 産官学プロジェクトへの参画(概要)

- カーボンニュートラルの実現に向けてエネルギー構造や産業構造の転換、大胆な投資によるイノベーションの創出が必要とされています。
- これまでの社会の延長にない飛躍的な目標を達成するため創出された、グリーンイノベーション基金のプロジェクトに当社が参画しております。

### NEDO※1グリーンイノベーション基金

- 日本政府が主導する「2050年カーボンニュートラル」宣言を達成するための基金
- 事業予算2兆円
- カーボンニュートラルに向けた研究開発、実証から社会実装に取り組む企業に最長10年間支援

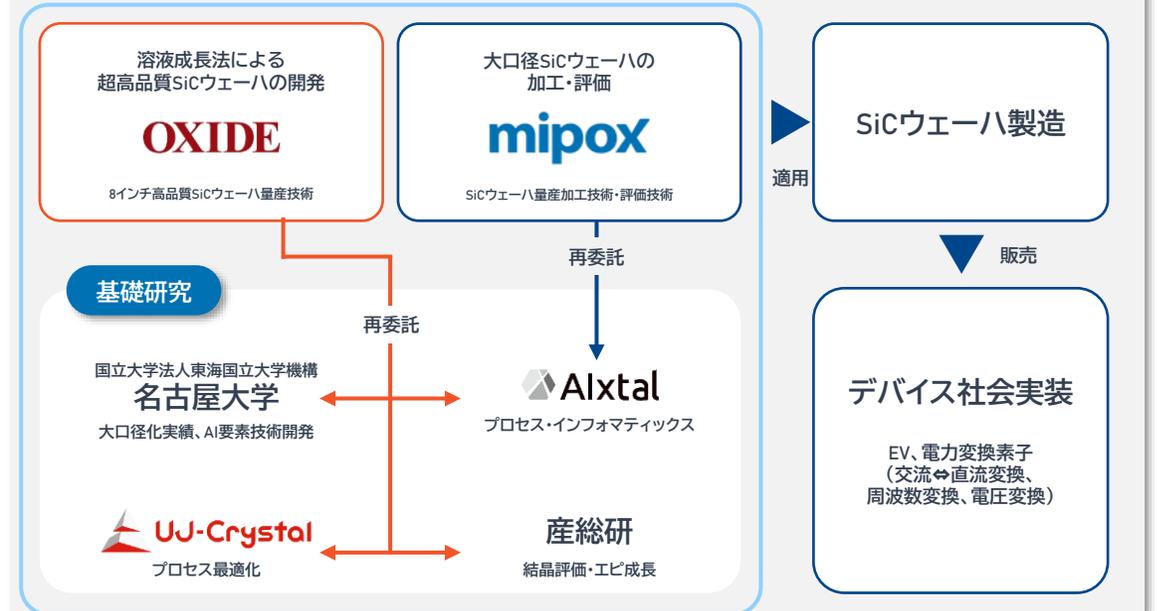


※1: 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

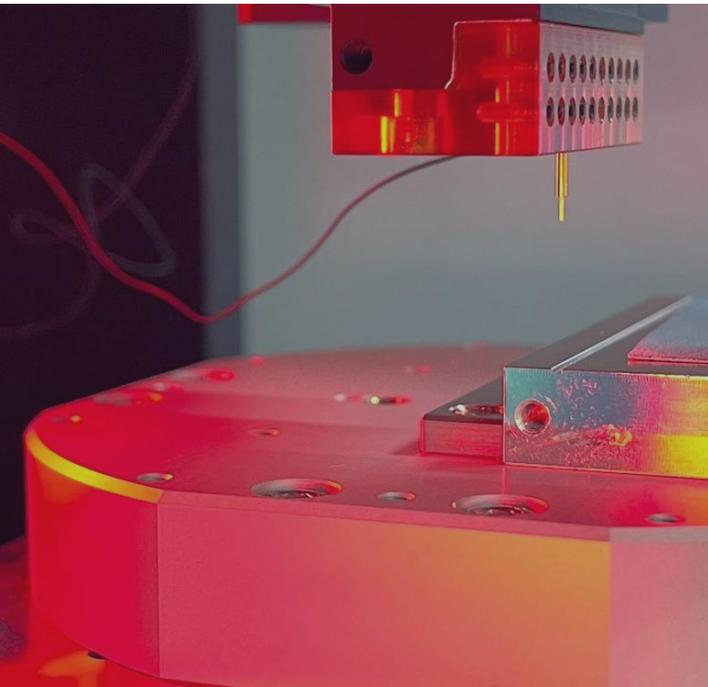
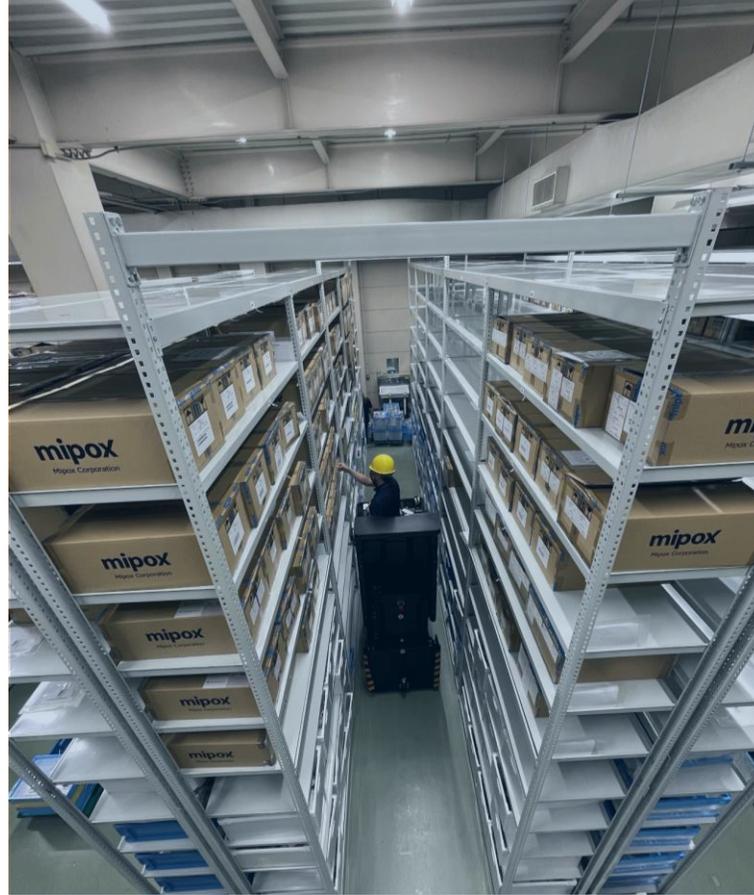
### プロジェクトの目的

超高品質・8インチ・低コストSiCウェーハ開発・販売

### 系統図



# Agenda



- 01 会社概要
- 02 2024年3月期 通期実績
- 03 通期業績見通し
- 04 事業内容
- 05 競争力の源泉
- 06 成長戦略
- 07 Appendix

## 変わることを忘れない『100年ベンチャー』

当社は1925年にドイツ・レイボルト商館の子会社として創業し、輸入した顔料を販売する傍ら主に出版物に使われる色箔の製造を生業としておりました。1960年代後半よりこの色箔を製造する中で培った「塗る」技術、それを裁断する「切る」技術を基に、精密部品の製造工程事業に使用される研磨フィルムを開発し、「塗る・切る・磨く」の3つのコア技術確立いたしました。

精密研磨材専門メーカーとして発展を経て、2000年初頭からはコア技術である『塗る』をサービスとして提供するエンジニアリングサービス(受託塗布)を開始いたしました。創業来の危機である2008～2010年を乗り越えたあとは、『磨く』をサービスとして提供するウエハープロセス(受託研磨)を立ち上げ、「塗る・切る・磨くで世界を変える」に取り組んでまいりました。2016年には研磨布紙メーカーである日本研紙を仲間に迎え、製品事業のラインナップの拡充を進めました。

創業から間もなく100年。事業を長く続けていくために、急速に変化するテクノロジーや世の中の価値観を敏感にとらえながら、自らも変化に順応していくことが求められます。こうした時代のニーズに対応するため、わたしたちが培ってきたコア技術をさらに高めながら、新しい事業にも積極的にチャレンジし、世の中に必要とされる製品やサービスを通じて世界のお客様に選ばれるパートナーを目指してまいります。

変わることを忘れない、『100年ベンチャー』を目指してこれからも変化し続ける集団でありつづけます。

今後とも皆様のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長 渡邊淳



01



代表取締役社長 **渡邊 淳** WATANABE Jun

日本とアメリカの大学で学んだ後、1994年当社へ入社。製造現場でキャリアをスタートし、生産技術、国内営業、海外営業を担当後マレーシア駐在員、米国子会社赴任を経験。その後半導体部門長、海外支援部門長に従事。2007年取締役、2008年に先代から引き継ぐ形で現職に就任。就任後は不採算事業撤退や拠点の統廃合を通して赤字からの脱却を行った。業績回復後は製造業として「技術・品質」に加え、デジタルを企業変革の柱と据えてIT推進をリード。

02



取締役 **中川 健二** NAKAGAWA Kenji

全自動水洗い洗濯機や半導体CMP後洗浄装置の開発、ハードディスクメディアむけ研磨テープや光学検査装置の技術営業を経験。独立後は光学検査装置のマーケティングから技術、営業や貿易などに携わる。2002年に独立後、2016年当社技術本部長、2019年経営企画部長兼経営管理部長に就任。経営全般に関わりながら、社内組織体制の構築やレフタイトのリブランディング活動に注力。2021年から新事業開発に携わり、GI基金の大口径SiCウェハの加工開発を統括している

03



取締役 **上谷 宗久** UETANI Munehisa

2000年に当社入社。台湾支店長や海外子会社の代表取締役を経て、2012年取締役営業本部長に就任。製造拠点の運営、競合他社とのM&A、そして民事再生を経た企業の事業承継等を担当。2017年に退職し、ITベンチャーにおける取締役COOとしての経験をはじめ、エンジニアリング企業での事業開発責任者としての役職を経た後に、2022年4月に当社に復帰。外部活動としてthomas株式会社の社外取締役も務める。

04



取締役 **仁平 洋亮** NIHIRA Yosuke

オリックスにて国内外の事業投資や海外子会社管理等の従事。デロイトでは10年間、国内外のM&A案件のアドバイザーサービスを提供。その他、投資後のPMIや事業管理関連サービスの提供や事業再生、地方創生、AIサービス開発等に関与。デロイト在籍中に双日へ出向しクライアントの立場から国内外のM&A案件の実行をサポート。当社入社後、取締役としてコーポレート本部およびDX本部の管掌を務めた後、財務経理全般を担当。

05



社外取締役（独立役員） **長井正和** NAGAI Masakazu

長瀬産業にて1973年から半導体を中心とする精密電子回路製造用機材の海外営業に25年間従事。1988年から6年間シリコンバレーに駐在し、三次元半導体パッケージ設計技術の日米企業間コラボを推進。2003年に独立し、トランスエッジ有限会社の代表として現在に至るまで主に半導体・回路板の技術・マーケティングのコンサルティングに従事。

	経営全般	グローバル 経営	ESG	DX戦略	財務・会計	研究・ 技術開発	M&A	マーケティング・ 営業	製造・ 生産技術
01 代表取締役社長 渡邊 淳	●	●	●	●			●		●
02 取締役 中川健二						●		●	●
03 取締役 上谷宗久		●		●			●	●	
04 取締役 仁平洋亮					●		●		
05 社外取締役 (独立役員) 長井正和	●	●				●		●	

## Environment



- 太陽光パネル導入の推進
- IH粉体塗装システム
- RTOの利用によるVOC削減
- LNGボイラの導入
- リサイクル素材を使用した製品の開発
- グリーンイノベーションへの取り組み
- ISO14001 にもとづいた環境負荷軽減

## Social

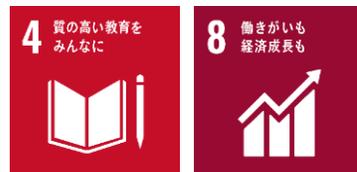


- Eラーニングによる社内教育の充実
- スーパーフレックスタイムの導入
- 人事評価システムの構築
- 資格取得の促進および取得後の手当の充実
- 労働災害事故の防止
- 若手の定着率の向上
- 女性従業員比率の向上

## Governance



- 透明性のある情報開示
- 内部通報窓口を外部企業に委託
- 全社員に対するコンプライアンス研修の実施
- グループ各社に対するガバナンスとモニタリング体制の強化



● 工場/オフィス ● 営業拠点

# mipox

## 営業拠点

仙台  
東京  
名古屋  
浜松

大阪  
広島  
高松  
福岡



## IRお問い合わせ

<https://www.mipox.co.jp/inquiry.html>



フェアディスクロージャーの観点から、公平な情報開示体制と株主様と投資家の皆様へのお問合せ対応の維持を考慮し、IRお問い合わせ窓口のお電話での対応をおこなっておりません。HPのお問い合わせフォームをご利用ください。

